

Électronique haute température

Contraintes sur la puce et le packaging

Cyril BUTTAY

Laboratoire Ampère, Lyon, France

21/6/18

Introduction

Composants

Packaging et Procédés

Conclusions

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

- ▶ Cette présentation se base principalement sur mes travaux de recherche (et ceux de collègues), elle n'a pas la prétention d'être exhaustive
- ▶ Les papiers correspondants sont indiqués en fin de présentation, avec les liens
- ▶ Pour toute question, approfondissement, vous pouvez me contacter par email cyril.buttay@insa-lyon.fr

Pourquoi la haute température ? ($>200\text{ }^{\circ}\text{C}$)



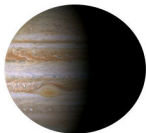
- ▶ Mettre des actionneurs électriques près des freins, réacteurs
- ▶ Cyclage thermique profond ($-55/+225\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Service long (jusqu'à 30 ans)

Pourquoi la haute température ? ($>200\text{ }^{\circ}\text{C}$)



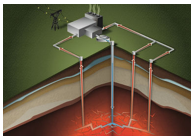
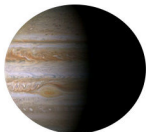
- ▶ Mettre des actionneurs électriques près des freins, réacteurs
- ▶ Cyclage thermique profond ($-55/+225\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Service long (jusqu'à 30 ans)
- ▶ Utiliser un seul circuit de refroidissement pour motorisation thermique et électrique
- ▶ Température liquide de refroidissement : $120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pourquoi la haute température ? ($>200\text{ }^{\circ}\text{C}$)



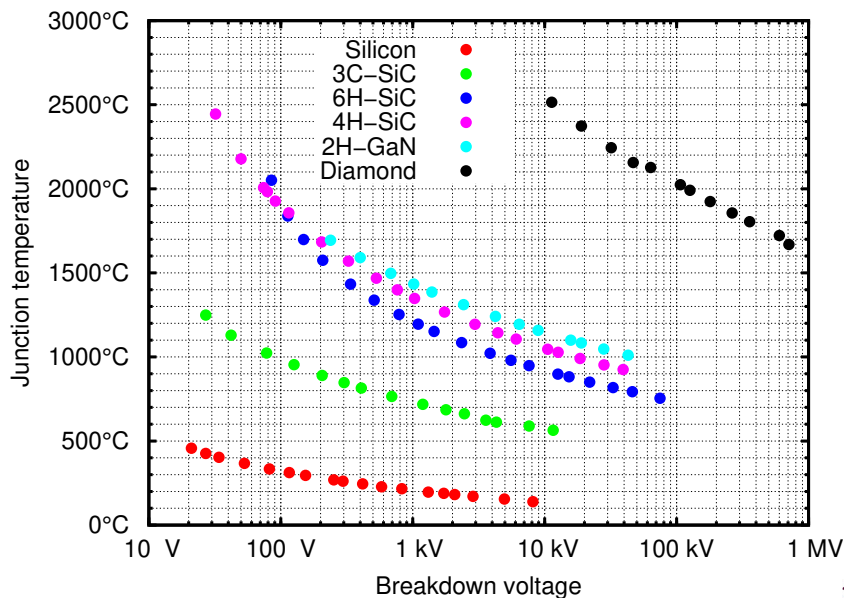
- ▶ Mettre des actionneurs électriques près des freins, réacteurs
- ▶ Cyclage thermique profond ($-55/+225\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Service long (jusqu'à 30 ans)
- ▶ Utiliser un seul circuit de refroidissement pour motorisation thermique et électrique
- ▶ Température liquide de refroidissement : $120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Mission NASA sur Venus : jusqu'à $480\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Mission vers Jupiter : 100 bars, $400\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pourquoi la haute température ? ($>200\text{ }^{\circ}\text{C}$)



- ▶ Mettre des actionneurs électriques près des freins, réacteurs
- ▶ Cyclage thermique profond ($-55/+225\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- ▶ Service long (jusqu'à 30 ans)
- ▶ Utiliser un seul circuit de refroidissement pour motorisation thermique et électrique
- ▶ Température liquide de refroidissement : $120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Mission NASA sur Venus : jusqu'à $480\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Mission vers Jupiter : 100 bars, $400\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ Forage gaz, pétrole ou géothermie
- ▶ Faible cyclage thermique, temp. ambiante élevée ($200\text{ à } > 300\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Les matériaux grands gaps pour la haute température [1]



Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

Qu'est-ce qui limite la température de fonctionnement ?

Exemple : diode SiC schottky ou MPS :

	matériau	temp. max	cause
Semiconducteur	SiC	2730 °C	sublimation
Metal schottky	Ti	1668 °C	fusion
Métallization sup.	Al	660 °C	fusion
passivation second.	polyimide	500-620 °C	décomposition
recuit contact [2]	Ti/Ni	350-500 °C	Réaction état solide

- ▶ certaines limites sont liées au composant (métal schottky) et peuvent être dépassées [3]
- ▶ D'autres seront listées plus loin (packaging)

Qu'est-ce qui limite la température de fonctionnement ?

Exemple : diode SiC schottky ou MPS :

	matériau	temp. max	cause
Semiconducteur	SiC	2730 °C	sublimation
Metal schottky	Ti	1668 °C	fusion
Métallization sup.	Al	660 °C	fusion
passivation second.	polyimide	500-620 °C	décomposition
recuit contact [2]	Ti/Ni	350-500 °C	Réaction état solide

- ▶ certaines limites sont liées au composant (métal schottky) et peuvent être dépassées [3]
- ▶ D'autres seront listées plus loin (packaging)

Qu'est-ce qui limite la température de fonctionnement ?

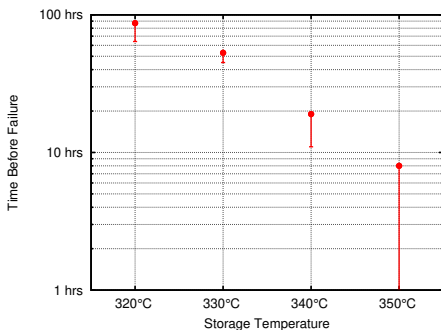
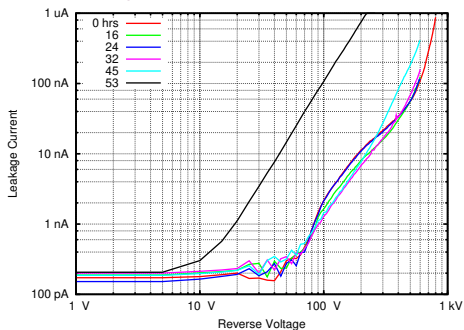
Exemple : diode SiC schottky ou MPS :

	matériau	temp. max	cause
Semiconducteur	SiC	2730 °C	sublimation
Metal schottky	Ti	1668 °C	fusion
Métallization sup.	Al	660 °C	fusion
passivation second.	polyimide	500-620 °C	décomposition
recuit contact [2]	Ti/Ni	350-500 °C	Réaction état solide

- ▶ certaines limites sont liées au composant (métal schottky) et peuvent être dépassées [3]
- ▶ D'autres seront listées plus loin (packaging)

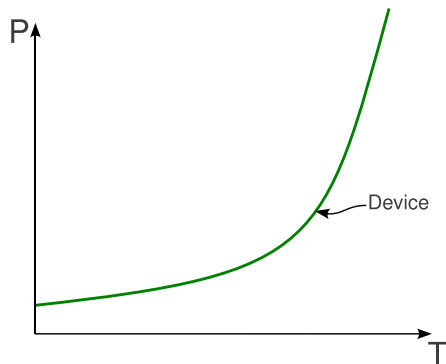
Vieillessement haute température de diodes SiC [4]

test @ 330 °C :



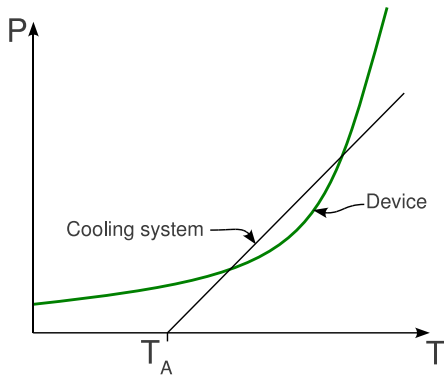
- ▶ recuit du contact schottky → augmentation du courant de fuite
- ▶ Ces diodes fonctionnent à 300 °C, pour quelques heures. . .

Mécanisme d'emballlement thermique



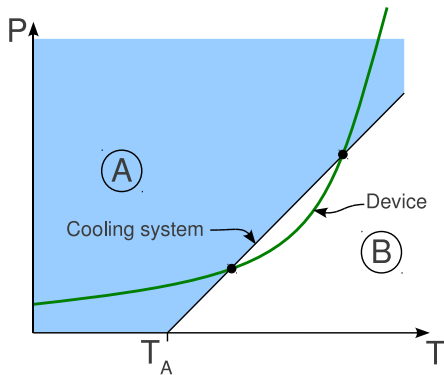
- ▶ Un composant arbitraire ;
- ▶ son système de refroidissement ;
- ▶ en région A, le composant dissipe plus que le radiateur peut extraire ;
- ▶ en region B, le composant dissipe moins ;
- ▶ deux points d'équilibre, un stable, un instable ;
- ▶ au-delà du point instable : emballlement.

Mécanisme d'emballlement thermique



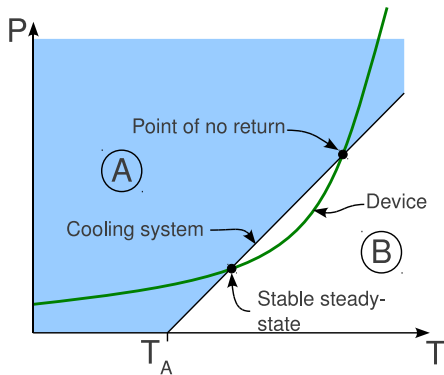
- ▶ Un composant arbitraire ;
- ▶ son système de refroidissement ;
- ▶ en région A, le composant dissipe plus que le radiateur peut extraire ;
- ▶ en region B, le composant dissipe moins ;
- ▶ deux points d'équilibre, un stable, un instable ;
- ▶ au-delà du point instable : emballement.

Mécanisme d'emballlement thermique



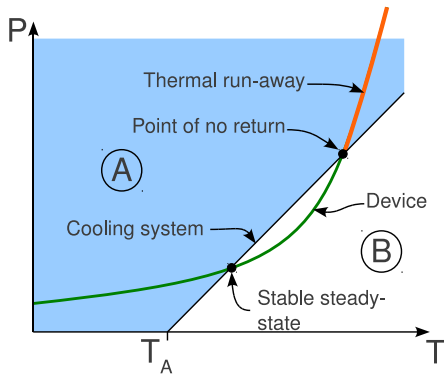
- ▶ Un composant arbitraire ;
- ▶ son système de refroidissement ;
- ▶ en région A, le composant dissipe plus que le radiateur peut extraire ;
- ▶ en region B, le composant dissipe moins ;
- ▶ deux points d'équilibre, un stable, un instable ;
- ▶ au-delà du point instable : emballement.

Mécanisme d'emballlement thermique



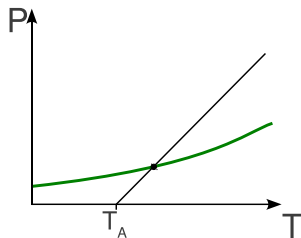
- ▶ Un composant arbitraire ;
- ▶ son système de refroidissement ;
- ▶ en région A, le composant dissipe plus que le radiateur peut extraire ;
- ▶ en region B, le composant dissipe moins ;
- ▶ deux points d'équilibre, un stable, un instable ;
- ▶ au-delà du point instable : emballement.

Mécanisme d'emballlement thermique



- ▶ Un composant arbitraire ;
- ▶ son système de refroidissement ;
- ▶ en région A, le composant dissipe plus que le radiateur peut extraire ;
- ▶ en region B, le composant dissipe moins ;
- ▶ deux points d'équilibre, un stable, un instable ;
- ▶ au-delà du point instable : emballement.

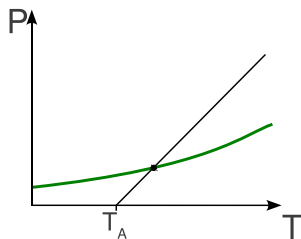
Mécanisme d'emballement thermique – 2



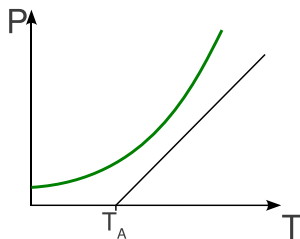
Toujours stable

- ▶ D'autres cas existent, comme un composant avec un coefficient de température négatif

Mécanisme d'emballlement thermique – 2



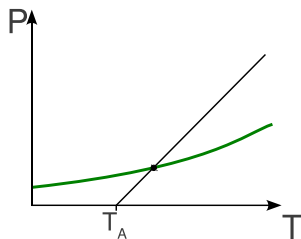
Toujours stable



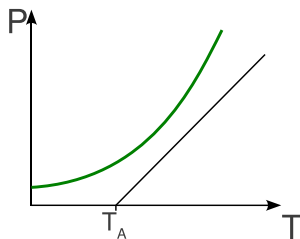
Toujours instable

- ▶ D'autres cas existent, comme un composant avec un coefficient de température négatif

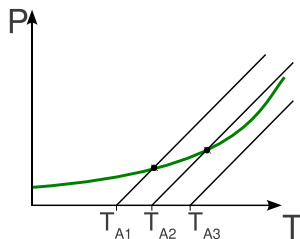
Mécanisme d'emballement thermique – 2



Toujours stable



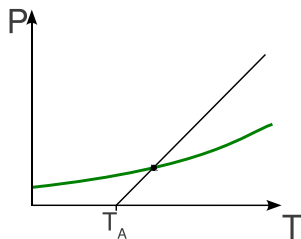
Toujours instable



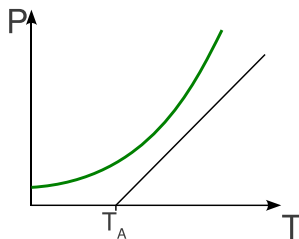
Stable devenant
instable quand T_A
augmente

- ▶ D'autres cas existent, comme un composant avec un coefficient de température négatif

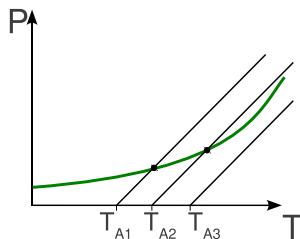
Mécanisme d'emballement thermique – 2



Toujours stable



Toujours instable

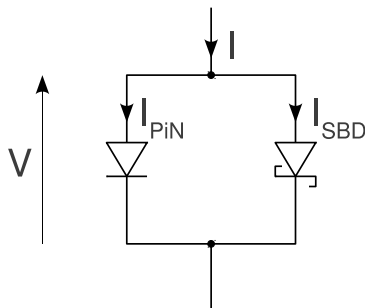
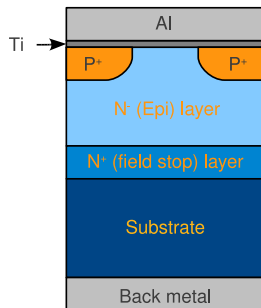


Stable devenant
instable quand T_A
augmente

- D'autres cas existent, comme un composant avec un coefficient de température négatif

Emballlement thermique : exemple de la diode [5]

Diode SiC Merged PiN-Schottky (MPS) de SiCED, puce
2,7x2,7 mm², 1200 V, 15 A

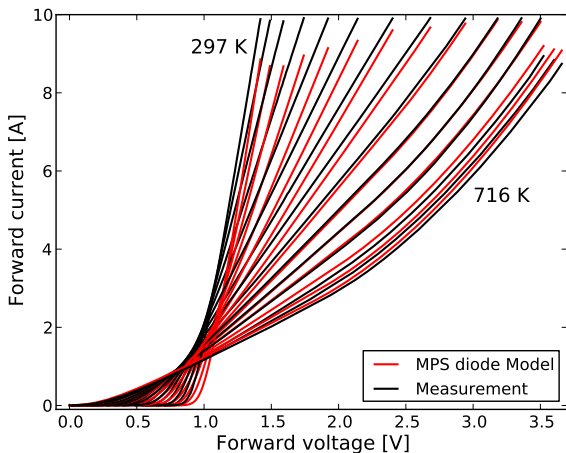


Modèle électrique en conduction : deux diodes en parallèle :

- ▶ une Schottky pure (SBD)
- ▶ une bipolaire pure (PiN)

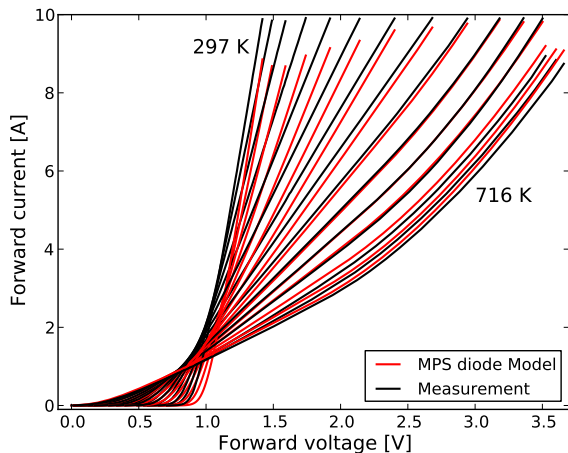
Emballlement thermique : exemple de la diode – 2

- ▶ un modèle analytique
 $I = f(V_F, T)$
empirique
- ▶ parties PiN et
Schottky modélisées
séparément



Emballlement thermique : exemple de la diode – 2

- ▶ un modèle analytique
 $I = f(V_F, T)$
empirique
- ▶ parties PiN et Schottky modélisées
séparément

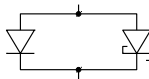


Jouons maintenant avec notre modèle

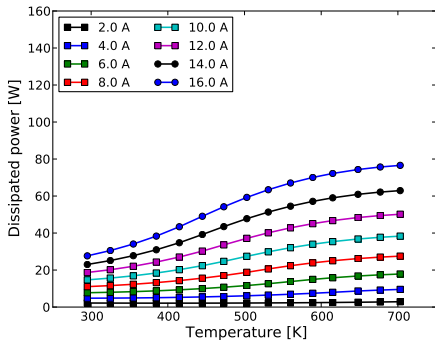
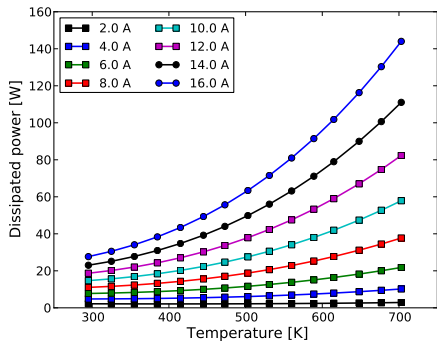
Emballage thermique : exemple de la diode – 3



Schottky pure



MPS

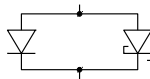


- Comportement identique à basse température, se couche à hte temp pour la MPS
- MPS plus stable, notamment en surcharge.

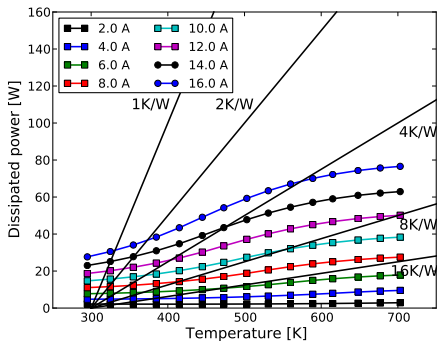
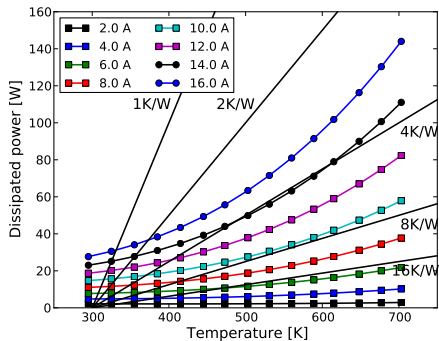
Emballage thermique : exemple de la diode – 3



Schottky pure



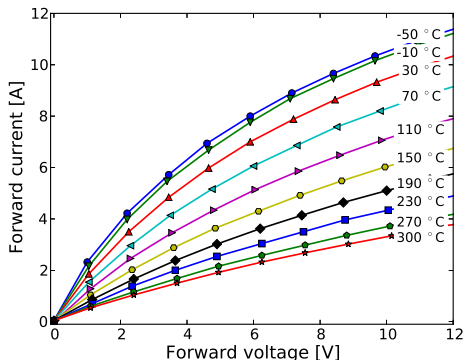
MPS



- ▶ Comportement identique à basse température, se couche à hte temp pour la MPS
- ▶ MPS plus stable, notamment en surcharge.

Emballement thermique : Exemple du JFET [6]

Caractéristique statique de JFET SiC 490 m Ω

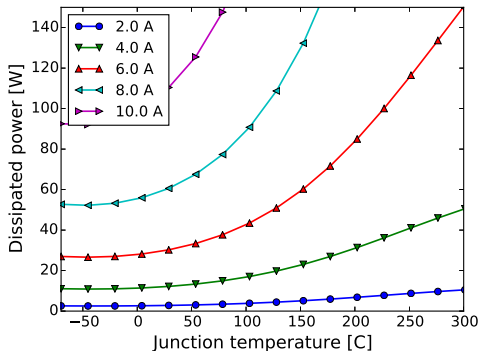
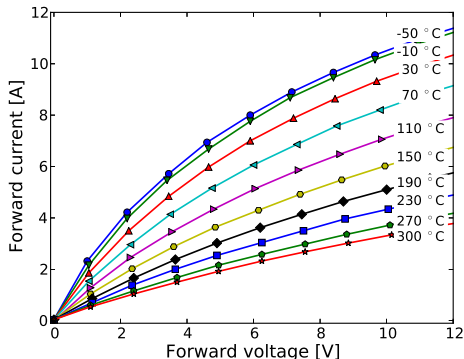


$V_{GS} = 0$ V, i.e. composant passant

- ▶ La résistance à l'état passant augmente fortement avec T_J ;
- ▶ les pertes en conduction sont donc très sensibles à T_J .

Emballage thermique : Exemple du JFET [6]

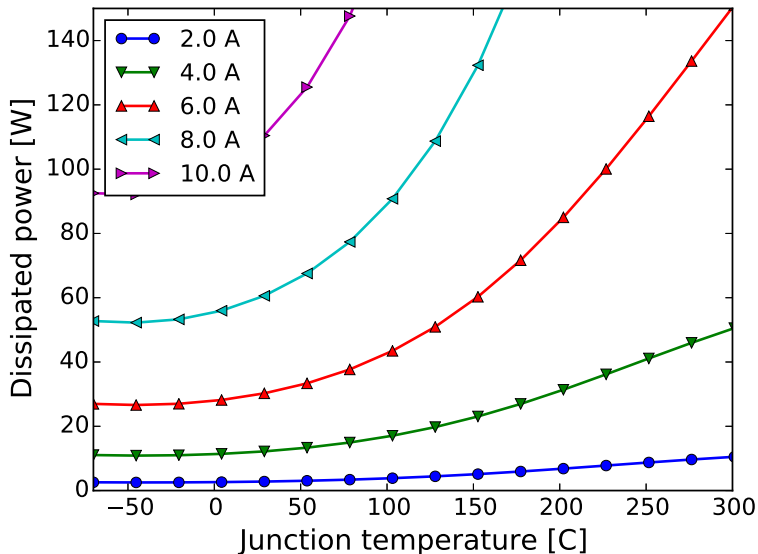
Caractéristique statique de JFET SiC 490 mΩ



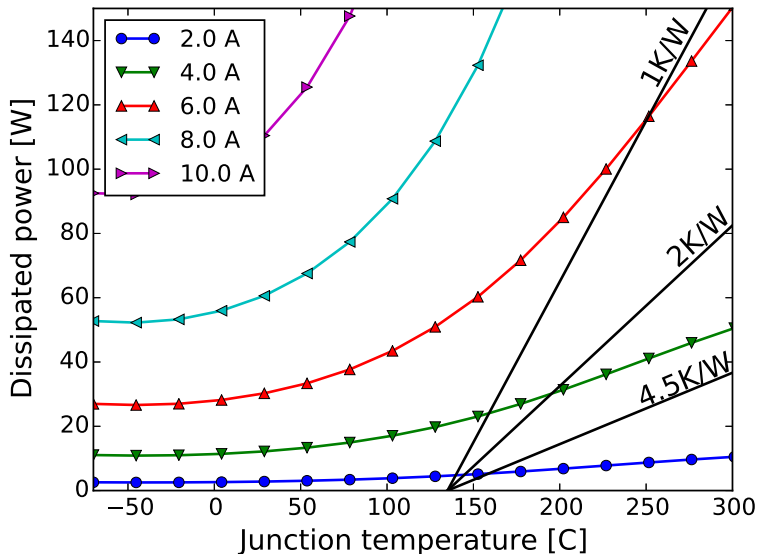
$V_{GS} = 0 \text{ V}$, i.e. composant passant

- ▶ La résistance à l'état passant augmente fortement avec T_J ;
- ▶ les pertes en conduction sont donc très sensibles à T_J .

Emballage thermique : Exemple du JFET – 2

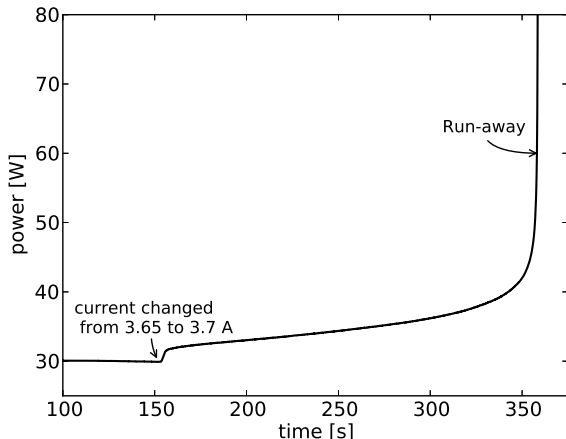


Emballage thermique : Exemple du JFET – 2



Emballage thermique : Exemple du JFET – 3

Buttay et al. "Thermal Stability of Silicon Carbide Power JFETs", IEEE Trans on Electron Devices, 2014



SiC JFET :

- ▶ 490 m Ω , 1200 V
- ▶ $R_{ThJA} = 4.5 K/W$
- ▶ 135 °C ambient
- ▶ On ne considère que les pertes en conduction

Composant haute temp. \neq besoin en refroidissement limités !
Un xFET SiC a besoin d'un radiateur à faible R_{Th} !



Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.
- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.
- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.

Mais la situation n'est pas désespérée :

- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.

Mais la situation n'est pas désespérée :

- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.

Mais la situation n'est pas désespérée :

- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

Deux limites liées aux composants (hors packaging) :

- ▶ vieillissement de certains éléments (ex. certains contacts Schottky)
 - ▶ peut se produire en quelques heures au-delà de 300 °C ;
- ▶ emballement thermique
 - ▶ un composant unipolaire (Si, SiC, GaN) devient instable si ses pertes ne sont pas évacuées, même à basse température.

Mais la situation n'est pas désespérée :

- ▶ certains composants supportent des températures plus élevées (contact Schottky W [3]) ;
- ▶ les composants bipolaires ou mixtes voient sont moins sujets à l'emballement thermique.

**Quelle que soit la température ambiante,
il faut évacuer la puissance dissipée !**

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

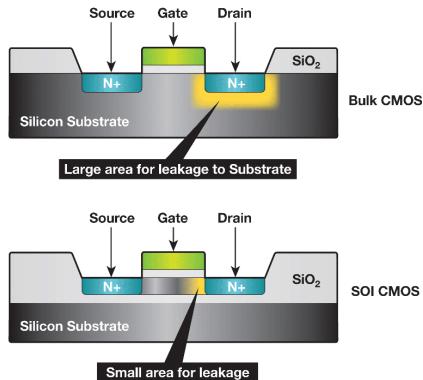
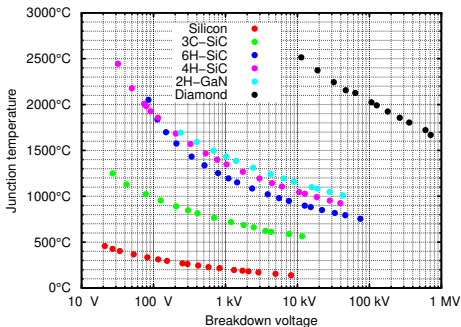
Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

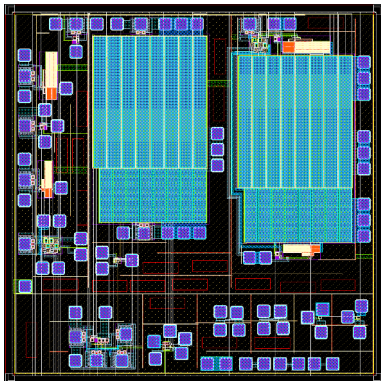
Technologie pour les circuits intégrés haute temp. [7]

- ▶ Le silicium est acceptable en basse tension (<100 V)
- ▶ Le SOI (Silicon on Insulator) peut être utilisé en haute température (faibles fuites).



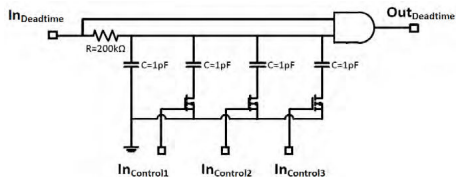
Honeywell ("Extreme Design: Developing integrated circuits for -55 degC to +250 °C", nov 2008)

Exemple de circuit de commande haute température



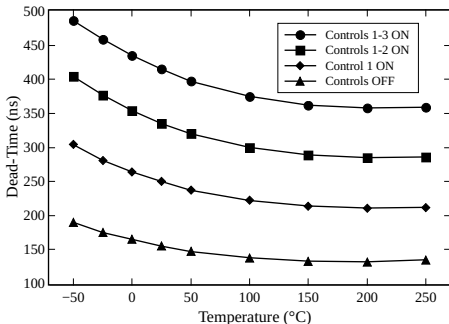
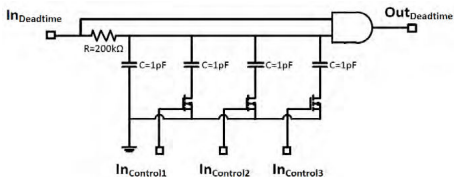
- ▶ Commande de JFET SiCED :
 - ▶ On : 0 V
 - ▶ Off : ≈ -24 V, 1 mA continu et ≈ 1 A pic
- ▶ Technologie : Smartis-1 (ATMEL) :
 - ▶ 0.8 μ m Bipolar-CMOS
 - ▶ Partially-depleted SOI
 - ▶ 3 couches métalliques AlSiCu

Génération de temps morts



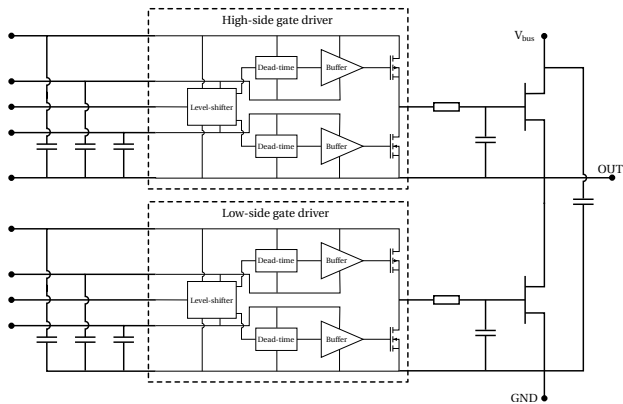
- ▶ La génération de délais est basée sur des circuits RC
- ▶ Utilisation de résistances à coefficient de température négatif pour compenser l'augmentation de résistance des interconnexions

Génération de temps morts

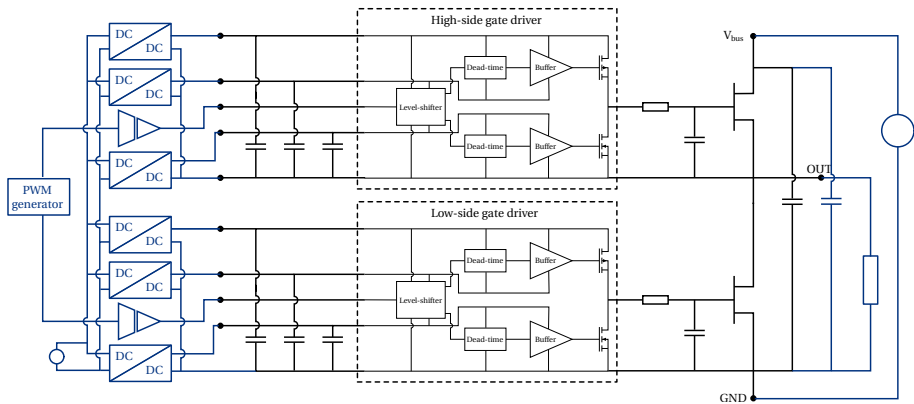


- ▶ La génération de délais est basée sur des circuits RC
- ▶ Utilisation de résistances à coefficient de température négatif pour compenser l'augmentation de résistance des interconnexions

Démonstrateur de convertisseur haute temp. [8]



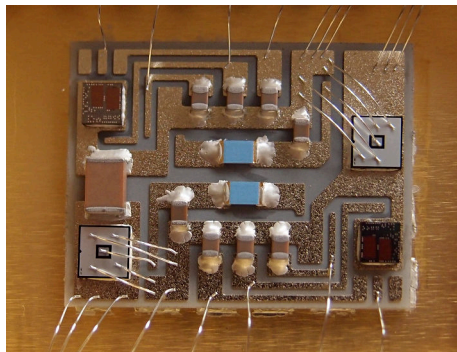
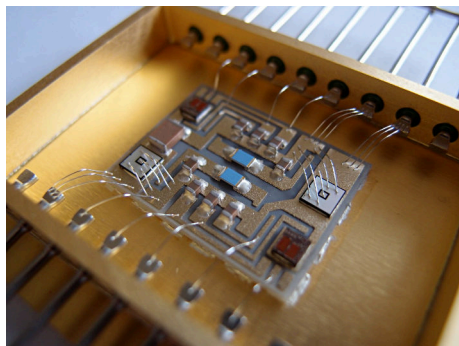
Démonstrateur de convertisseur haute temp. [8]



Encore à basse température :

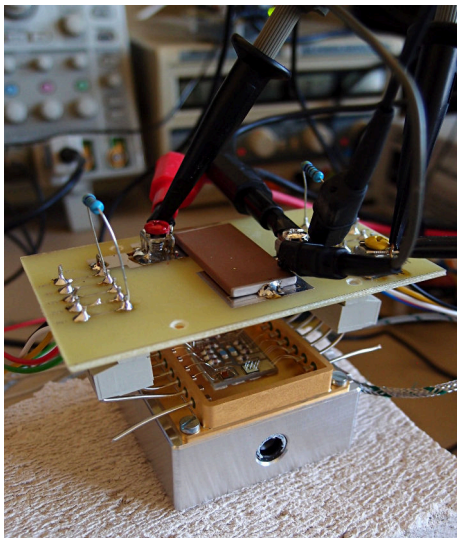
- ▶ Fonction d'isolation (signal et puissance)
- ▶ Génération des signaux de commande
- ▶ Capacité de découplage principale ($1 \mu F$)

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 2



- ▶ Boîtier métallique, semelle CuMo / cadre NiFe
- ▶ Substrat céramique (AlN) $\approx 20 \times 30 \text{ mm}^2$
- ▶ Passifs haute temp. (Vishay, Presidio)
- ▶ Wirebonds Al wedge, Au ball pour les circuits driver
- ▶ Report de tous les composants : frittage argent.

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 3



Pas d'encapsulation

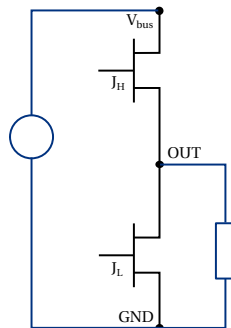
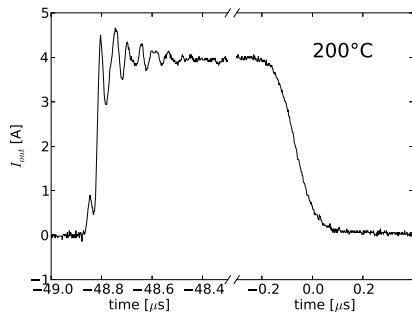
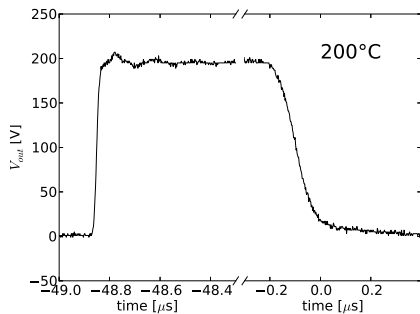
→ V_{DC} limité à 200 V

Démonstrateur attaché à un bloc chauffant

→ test de l'ambiante à 315 °C

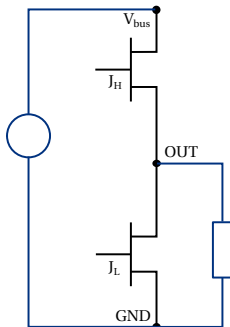
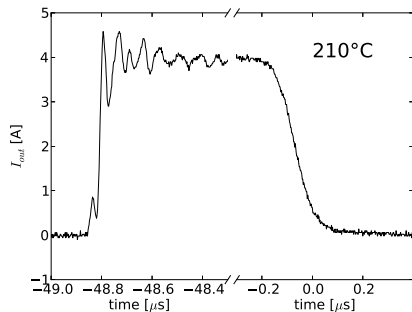
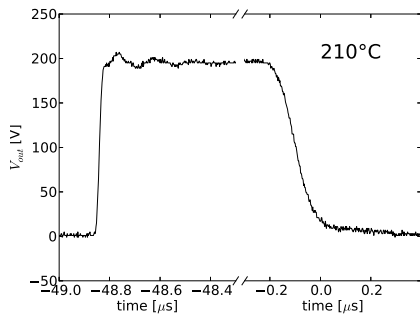
Opération continue sur une résistance

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



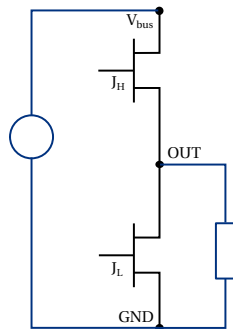
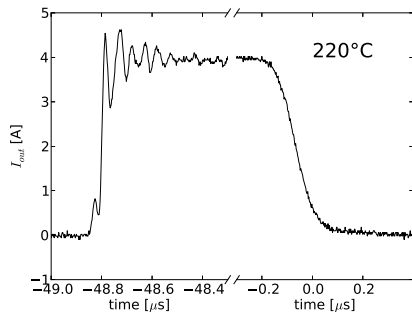
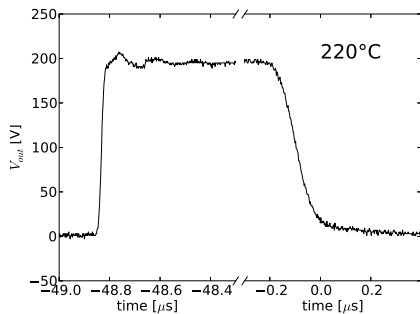
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



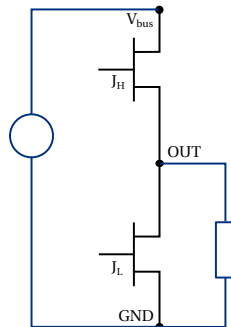
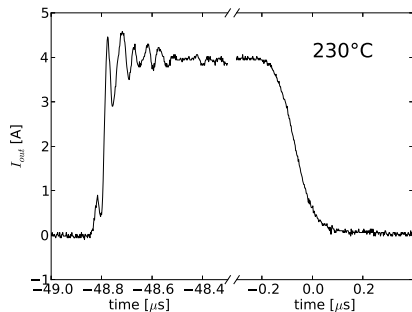
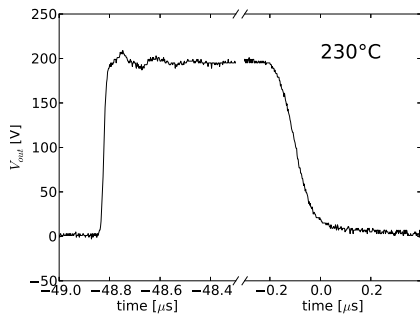
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



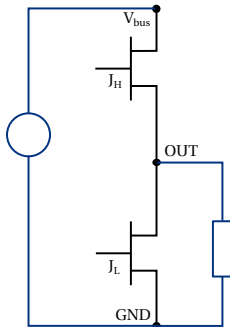
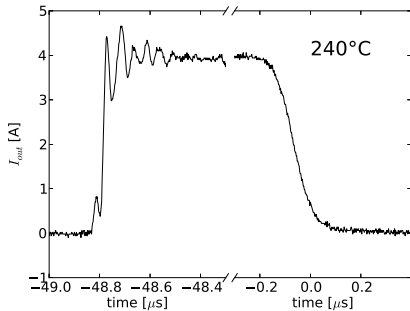
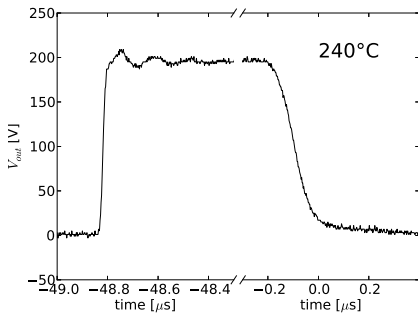
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



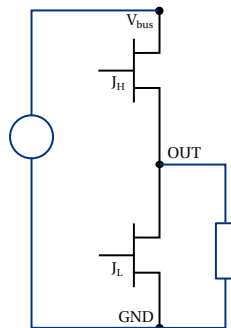
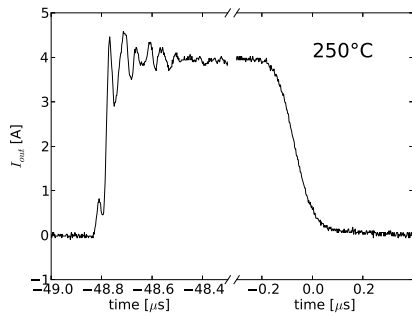
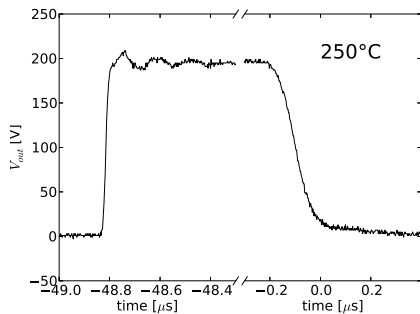
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



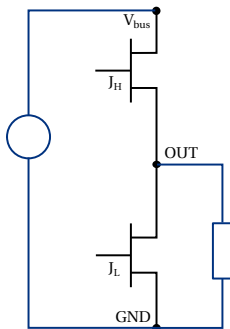
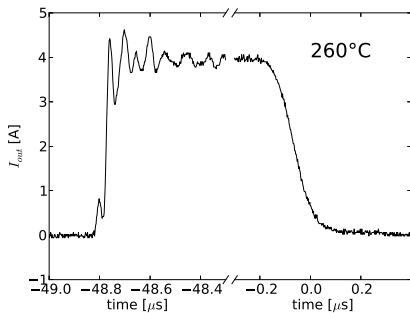
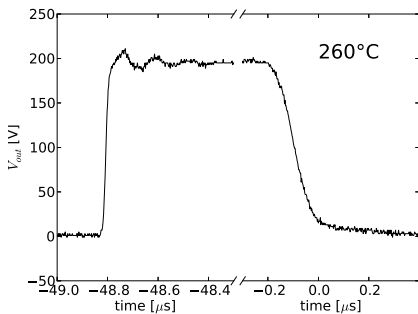
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



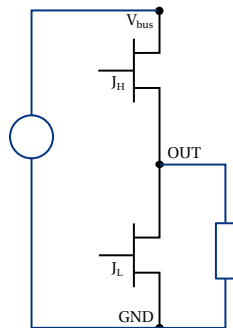
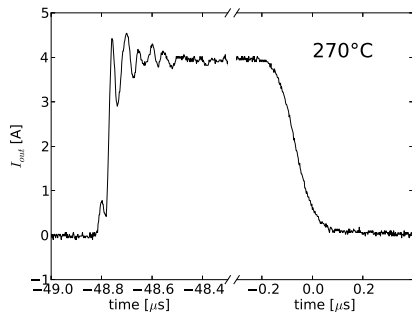
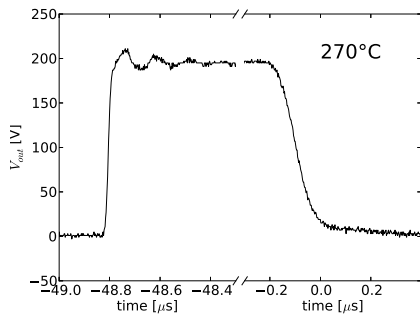
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



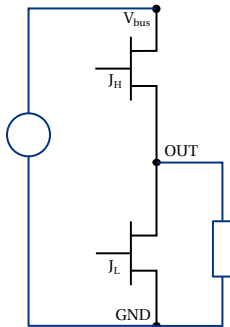
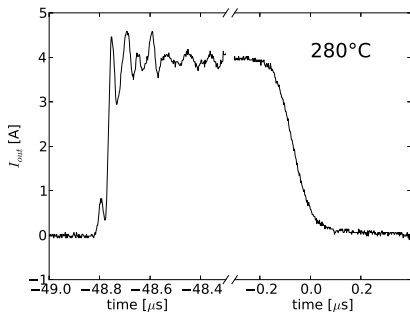
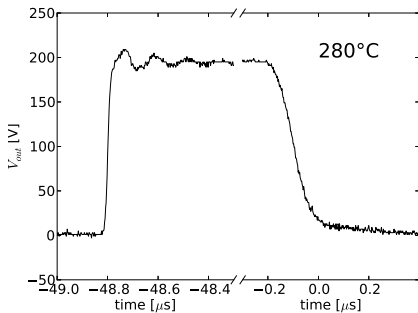
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



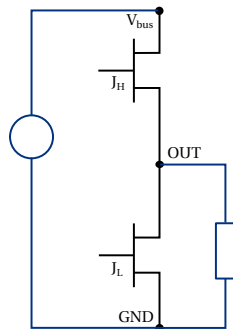
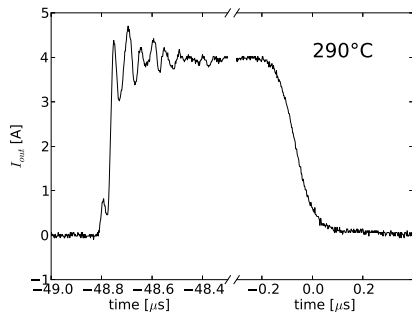
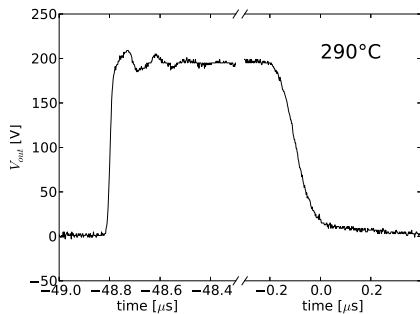
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



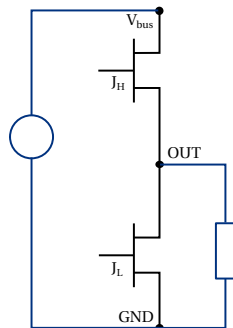
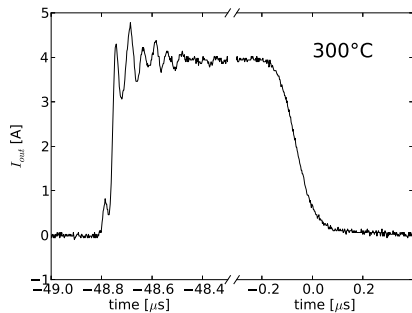
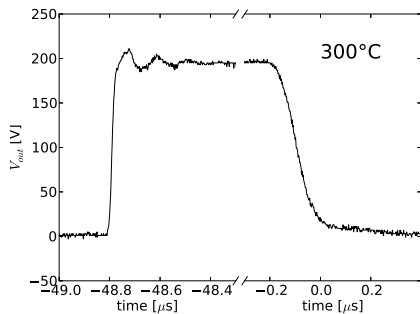
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



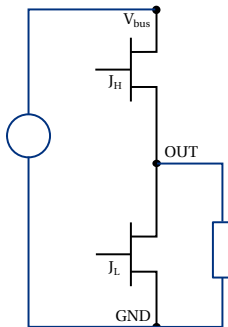
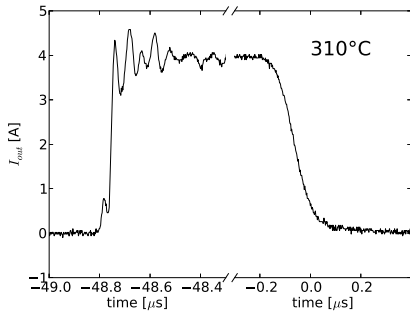
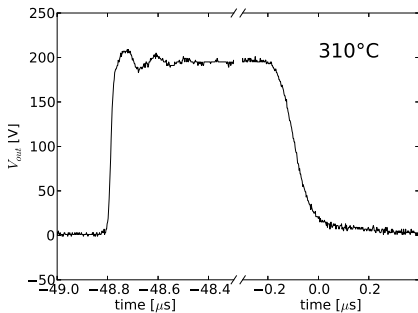
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



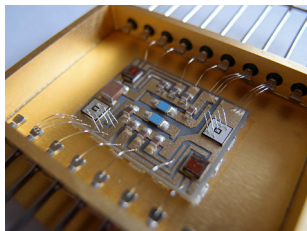
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Démonstrateur de convertisseur haute temp. – 4



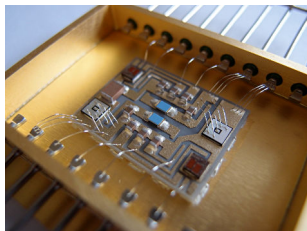
- ▶ $V_{DC} = 200 \text{ V}$ (no encapsulation)
- ▶ $R_{load} = 50 \Omega$
- ▶ $F_{switch} = 10 \text{ kHz}$
- ▶ $t_{dead-time} = 1.2 \mu\text{s}$

Conclusions sur les drivers



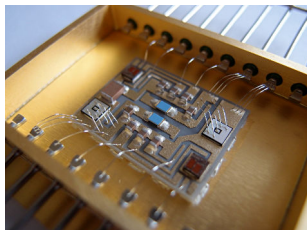
- ▶ Le module a arrêté de fonctionner à 315 °C
 - ▶ Il a redémarré dès que la température a baissé à nouveau.
- ▶ Formes d'ondes propres
 - ▶ fermeture rapide (≈ 15 ns) ;
 - ▶ ouverture lente à cause d'un large temps mort et de la charge résistive ;
 - ▶ intérêt de rapprocher driver et (petit) découplage des interrupteurs.
- ▶ Pour aller plus loin :
 - ▶ encapsuler le module (polyimide HT) ;
 - ▶ rendre l'ensemble du circuit compatible avec la haute température.

Conclusions sur les drivers

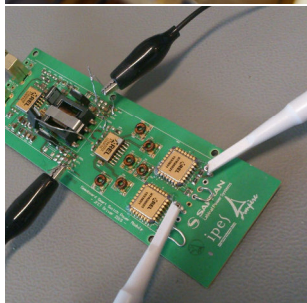


- ▶ Le module a arrêté de fonctionner à 315 °C
 - ▶ Il a redémarré dès que la température a baissé à nouveau.
- ▶ Formes d'ondes propres
 - ▶ fermeture rapide ($\approx 15 \text{ ns}$);
 - ▶ ouverture lente à cause d'un large temps mort et de la charge résistive;
 - ▶ intérêt de rapprocher driver et (petit) découplage des interrupteurs.
- ▶ Pour aller plus loin :
 - ▶ encapsuler le module (polyimide HT)
 - ▶ rendre l'ensemble du circuit compatible avec la haute température.

Conclusions sur les drivers



- ▶ Le module a arrêté de fonctionner à 315 °C
 - ▶ Il a redémarré dès que la température a baissé à nouveau.
- ▶ Formes d'ondes propres
 - ▶ fermeture rapide (≈ 15 ns) ;
 - ▶ ouverture lente à cause d'un large temps mort et de la charge résistive ;
 - ▶ intérêt de rapprocher driver et (petit) découplage des interrupteurs.



- ▶ Pour aller plus loin :
 - ▶ encapsuler le module (parlyène HT) ;
 - ▶ rendre l'ensemble du circuit compatible avec la haute température.

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

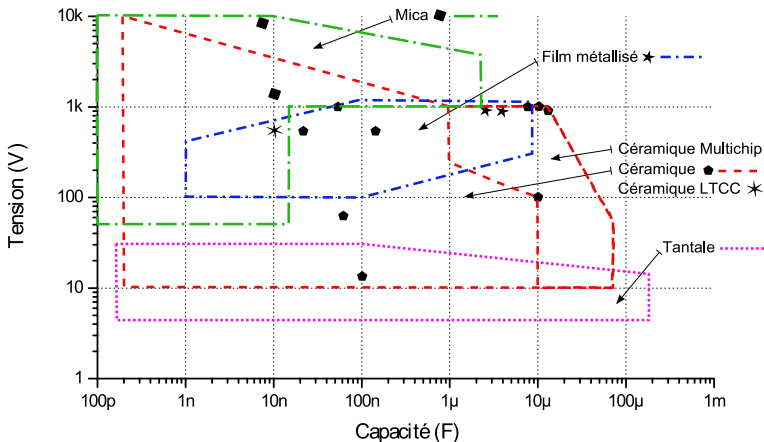
Conclusions

Condensateurs [4]

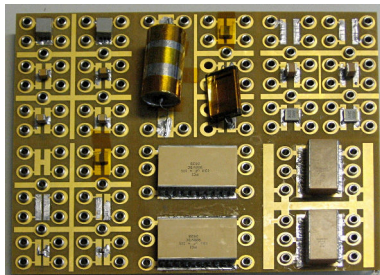
Beaucoup de technologies sont inutilisables en haute température :

- ▶ Electrochimiques
- ▶ Nombreux films (PET, PC, PPS, PP)

Au-delà de 200 °C, il reste [9] :



Viellissement de condensateurs [4]



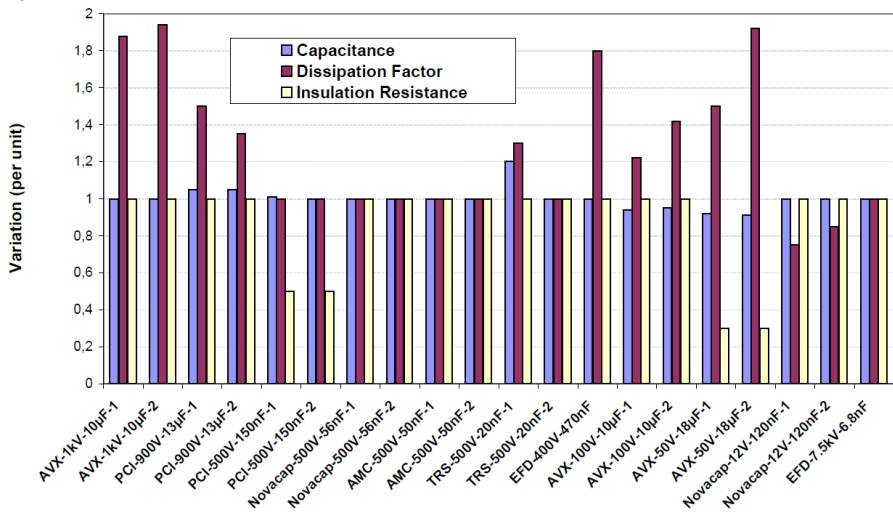
Vue d'ensemble de la carte de test

20 échantillons de différentes technologies/fabricants pour des applications EP

Manuf.	Nom.	Capacité (1V/1kHz)	Dielectrique	Utilisation
AVX	1kV	10 μ F	X7R	DC-link
PCI	900V	13 μ F	X7R/BX	DC-link
PCI	500V	150nF	X7R/BX	Common Mode
Novacap	500V	56nF	NP0	Common Mode
AMC	500V	50nF	NP0	Common Mode
TRS	500V	20nF	HT300	Common Mode
EFD	400V	470nF	PTFE	DC-link
AVX	100V	10 μ F	X7R	DC-link cap-SMPS
AVX	50V	18 μ F	X7R	DC-link cap-SMPS
Novacap	12V	120nF	H type	Control Board
EFD	7.5kV	6.8nF	Mica	Common Mode

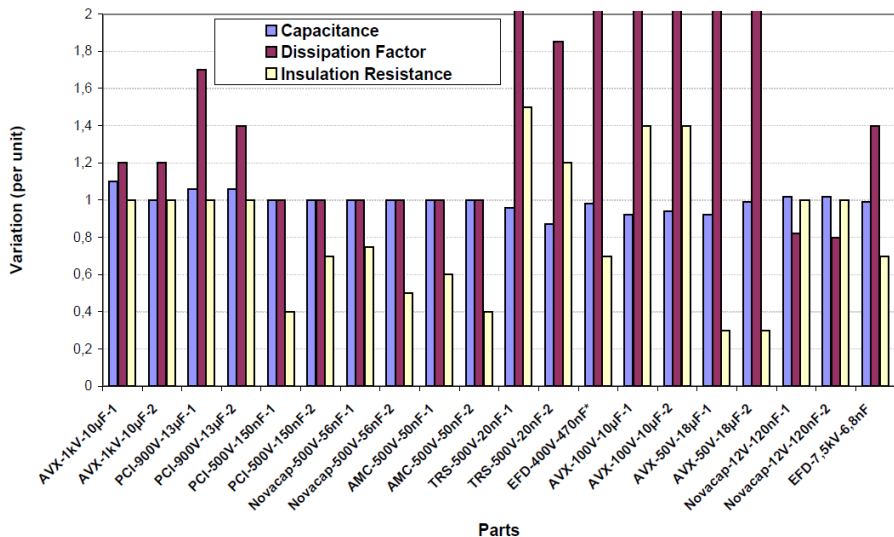
Vieillesse de condensateurs [4] – 2

Après 1000 h à 200 °C



Vieillesse de condensateurs [4] – 3

Après 1000 h à 200 °C, puis augmentation de 10 °C toutes les 200 h jusqu'à 250 °C

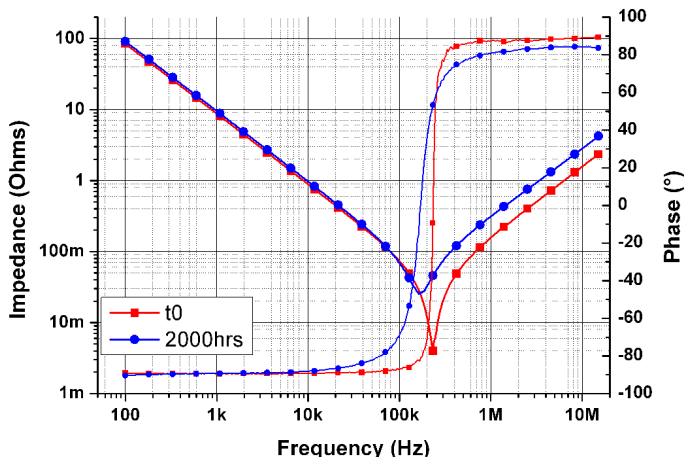


*Après 1800 h pour les EFD-400V-470nF pour cause de défaillance durant la dernière étape

Vieillessement de condensateurs [4] – 4

Variation d'impédance pour un condensateur X7R

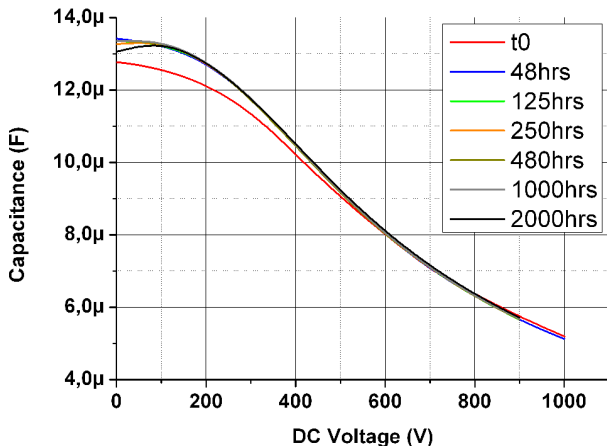
Échantillon AVX-50V-18 μ F #1



Effet du vieillissement sur la capacité et sur le facteur de dissipation.

Vieillessement de condensateurs [4] – 4

Variation d'impédance pour un condensateur X7R
Échantillon PCI-900V-13 μ F #1



Capacité non linéaire, varie fortement avec la polarisation électrique



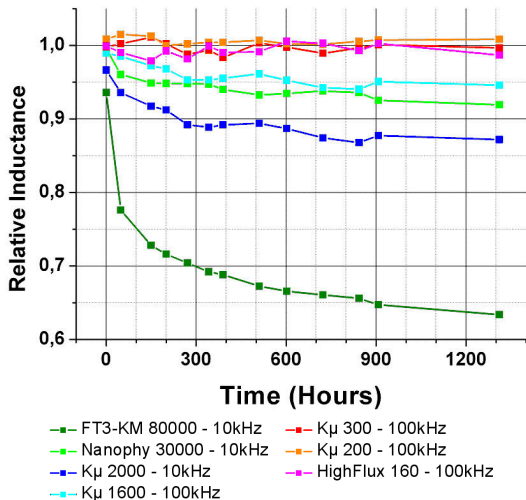
Vieillesse de matériaux magnétiques [4]



Noyaux sous test

Matériau	Perm.	Js (T)	Température de Curie (°C)	Utilisation possible
HighFlux	160	1.5	500	Inductance mode diff.
$k_{\mu}200$	200	1.25	570	Inductance mode diff.
$k_{\mu}300$	300	1.25	570	Inductance mode diff.
$k_{\mu}1600$	1600	1.25	570	Capteur de courant
$k_{\mu}2000$	2000	1.25	570	Capteur de courant
Nanophy	30000	1.25	570	Inductance mode commun
FT-3KM	80000	1.25	570	Inductance mode commun

Vieillessement de matériaux magnétiques [4] – 2



Les matériaux haute perméabilité sont le plus affectés par le vieillissement à 200 °C

Condensateurs

- ▶ Peu de technologies disponibles au-delà de 200 °C pour l'EP
 - ▶ Vieillissement net de toutes les technologies à 250 °C
 - ▶ Mécanismes de vieillissement complexes (effet différents suivant les condensateurs)
-
- ▶ Les matériaux faible perméabilité sont peu affectés à 200 °C
 - ▶ Nombreux problèmes de packaging (encapsulant, isolant. . .) en HT
- La limite en température est surtout liée au packaging

Condensateurs

- ▶ Peu de technologies disponibles au-delà de 200 °C pour l'EP
- ▶ Vieillessement net de toutes les technologies à 250 °C
- ▶ Mécanismes de vieillissement complexes (effet différents suivant les condensateurs)

Matériaux magnétiques

- ▶ Les matériaux faible perméabilité sont peu affectés à 200 °C
 - ▶ Nombreux problèmes de packaging (encapsulant, isolant. . .) en HT
- La limite en température est surtout liée au packaging

Composants disponibles jusqu'à 200 – 250 °C

- ▶ Composants actifs (SiC notamment) :
 - ▶ Diode, MOSFET (le JFET et le BJT se font rares)
 - ▶ Et il faut les refroidir convenablement !
- ▶ SOI pour les circuits intégrés
- ▶ Passifs : il faut évaluer leur vieillissement au cas par cas

Pour aller au-delà

- ▶ Quelques composants SiC supportent 300 °C ou plus
- ▶ Il existe des technologies de circuits intégrés WBG
- ▶ Les passifs manquent (condensateurs, notamment)
- ▶ Dans l'ensemble, il s'agit de technologies « recherche »

Composants disponibles jusqu'à 200 – 250 °C

- ▶ Composants actifs (SiC notamment) :
 - ▶ Diode, MOSFET (le JFET et le BJT se font rares)
 - ▶ Et il faut les refroidir convenablement !
- ▶ SOI pour les circuits intégrés
- ▶ Passifs : il faut évaluer leur vieillissement au cas par cas

Pour aller au-delà

- ▶ Quelques composants SiC supportent 300 °C ou plus
- ▶ Il existe des technologies de circuits intégrés WBG
- ▶ Les passifs manquent (condensateurs, notamment)
- ▶ Dans l'ensemble, il s'agit de technologies « recherche »

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

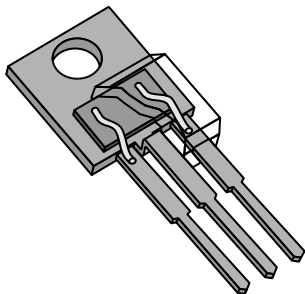
Généralités Packaging

Attache de composants

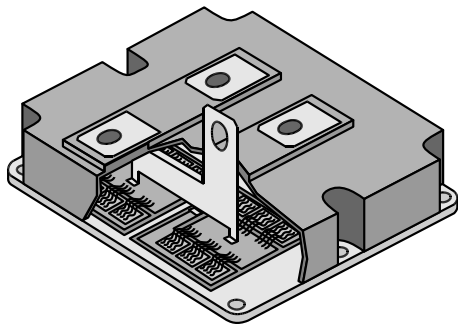
Circuits imprimés

Conclusions

Deux classes : discrets et modules



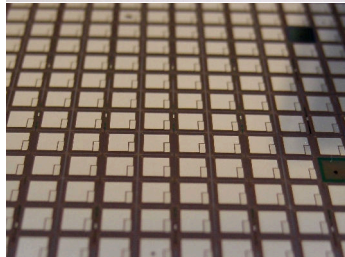
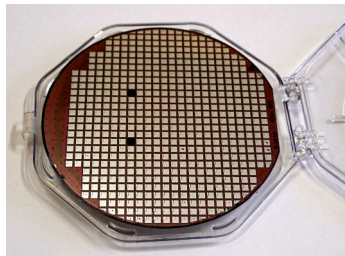
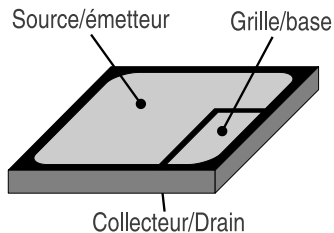
- ▶ Un composant élémentaire (transistor, diode) par boîtier
- ▶ (souvent) Pas d'isolation
- ▶ Puissances faibles ou très fortes



- ▶ Plusieurs puces par boîtier
- ▶ Forme un circuit ou un seul composant élémentaire
- ▶ Assure l'isolation électrique
- ▶ Puissances moyennes à fortes

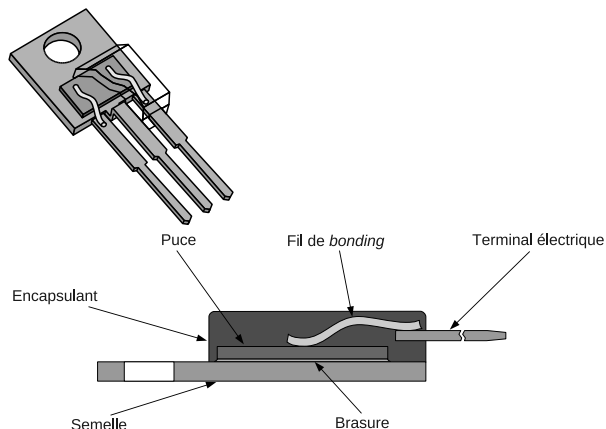
Puces de puissance

- ▶ Structure verticale, avec un (ou deux) contacts dessus et un dessous
- ▶ Épaisseur de 50 à 500 μm
- ▶ Côté de 1 à 13 mm

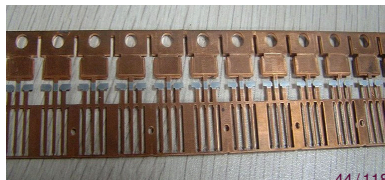


wafer IGBT International Rectifier, puces de 5x5 mm, wafer diamètre 6 pouces

Structure d'un boîtier discret

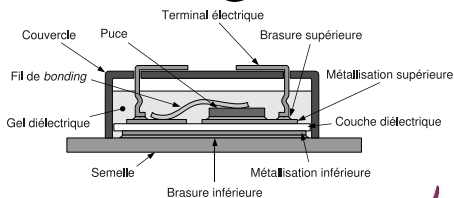
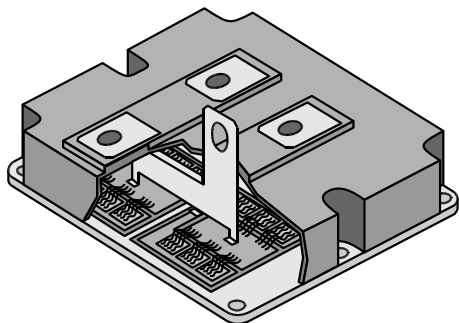


- ▶ technologie bas coût ;
- ▶ grande cadence de production ;
- ▶ matériaux : cuivre, brasure, aluminium, epoxy
- ▶ courant max. < 100 A



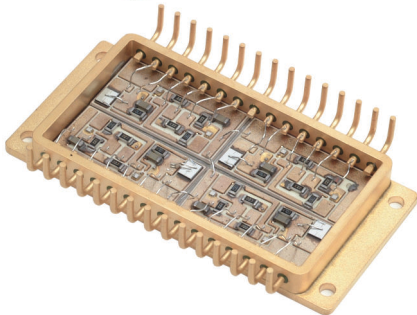
Modules

- ▶ Plusieurs puces
 - ▶ Un composant équivalent (transistor, diode)
 - ▶ Un circuit complet (onduleur, redresseur...)
- ▶ Besoin d'isolation électrique
- ▶ Peu standardisé
- ▶ Courant max < 3600 A
- ▶ Tension max < 6500 V
- ▶ Dimensions de qqes cm de côté à 20x15x5 cm
- ▶ Plusieurs constructeurs européens (ABB, Infineon, Microsemi, Dynex, Semikron...)





- ▶ Plusieurs types de boîtiers
 - ▶ Plastique
 - ▶ Hermétique
- ▶ Ajout de fonctions
 - ▶ Capteurs (courant, température)
 - ▶ Circuits de commande
 - ▶ ...



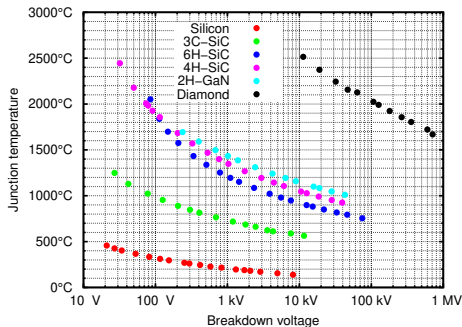
Sources images : Dynex (en haut) et Semelab (en bas)

Limites thermiques

Quelques limites :

- 2500 °C fusion/sublimation GaN/SiC
- 1414 °C fusion du silicium
- 660 °C fusion de l'aluminium
- ≈ 300 °C fusion de la brasure de puce
- 217 °C fusion de SAC 305

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.



Limites thermiques

Quelques limites :

2500 °C fusion/sublimation
GaN/SiC

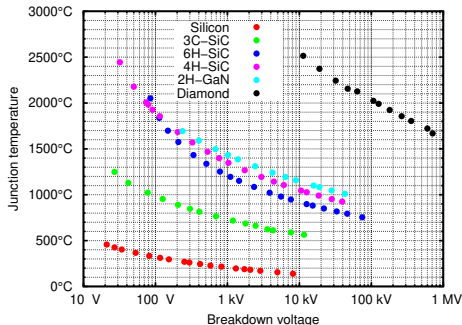
1414 °C fusion du silicium

660 °C fusion de l'aluminium

≈ 300 °C fusion de la brasure
de puce

217 °C fusion de SAC 305

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.

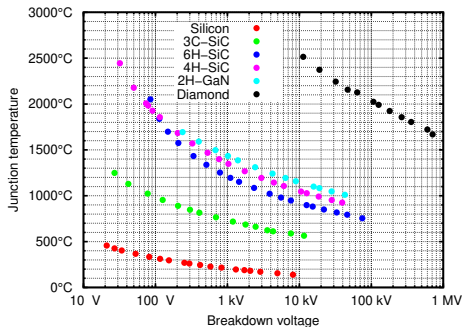


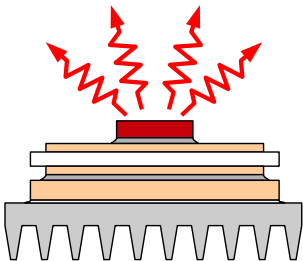
Limites thermiques

Quelques limites :

- 2500 °C fusion/sublimation GaN/SiC
- 1414 °C fusion du silicium
- 660 °C fusion de l'aluminium
- ≈ 300 °C fusion de la brasure de puce
- 217 °C fusion de SAC 305

- ▶ De nombreux composants (MOSFETs, diodes) sont moins performants lorsque la température augmente.
- ▶ Les fortes variations de température posent des problèmes de fiabilité.





► Rayonnement

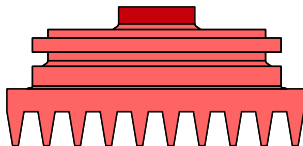
- Loi de Stefan-Boltzmann : $P = \varepsilon S \sigma T^4$
avec $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ et $\varepsilon < 1$
- à 400 K, $P=0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- **Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique**

► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$, $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec $e=100 \mu\text{m}$, $S=1 \text{ cm}^2$ et $\Delta T=1 \text{ }^\circ\text{C}$, $P=400 \text{ W}$

► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements. . .)



► Rayonnement

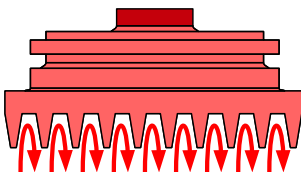
- Loi de Stefan-Boltzmann : $P = \varepsilon S \sigma T^4$
avec $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ et $\varepsilon < 1$
- à 400 K, $P = 0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique

► Conduction

- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$, $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec $e = 100 \mu\text{m}$, $S = 1 \text{ cm}^2$ et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$, $P = 400 \text{ W}$

► Convection

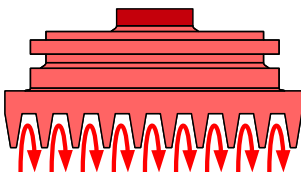
- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements. . .)



- ▶ Rayonnement
 - ▶ Loi de Stefan-Boltzmann : $P = \varepsilon S \sigma T^4$
avec $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ et $\varepsilon < 1$
 - ▶ à 400 K, $P = 0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
 - ▶ Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique
- ▶ Conduction
 - ▶ transfert de chaleur dans la matière
 - ▶ $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$, $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 - ▶ Pour une piste en cuivre avec $e = 100 \mu\text{m}$, $S = 1 \text{ cm}^2$ et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$, $P = 400 \text{ W}$
- ▶ Convection
 - ▶ Déplacement de matière
 - ▶ Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements...)

► Rayonnement

- Loi de Stefan-Boltzmann : $P = \varepsilon S \sigma T^4$
avec $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ et $\varepsilon < 1$
- à 400 K, $P = 0,15 \text{ W} \cdot \text{cm}^{-2}$
- Négligeable pour les dimensions et températures classiques de l'électronique



► Conduction

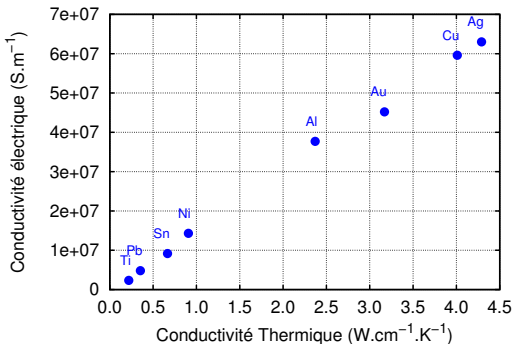
- transfert de chaleur dans la matière
- $P = -\frac{\lambda S}{e} \Delta T$, $\lambda = 20 \dots 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Pour une piste en cuivre avec $e = 100 \mu\text{m}$, $S = 1 \text{ cm}^2$ et $\Delta T = 1 \text{ }^\circ\text{C}$, $P = 400 \text{ W}$

► Convection

- Déplacement de matière
- Pas d'expression simple (convection forcée, naturelle, type d'écoulements...)

La gestion thermique en électronique repose sur deux mécanismes : conduction et convection

Relation entre conductivités thermique et électrique



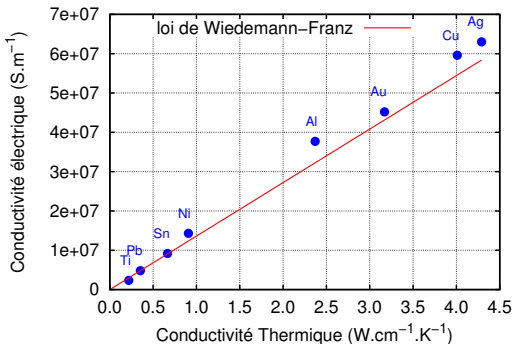
cond. thermique $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

▶ λ_e : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

▶ λ_p : phonons (vibrations réseau atomique)

Relation entre conductivités thermique et électrique



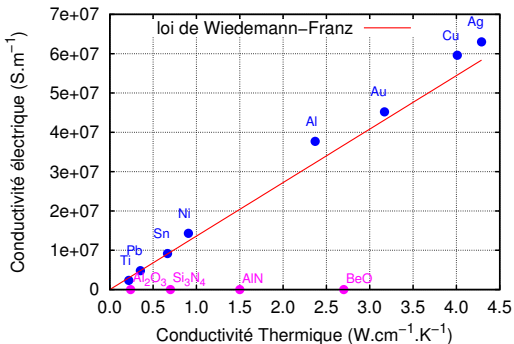
cond. thermique $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

► λ_e : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

► λ_p : phonons (vibrations réseau atomique)

Relation entre conductivités thermique et électrique



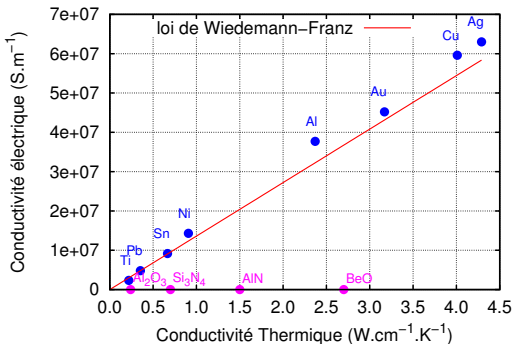
cond. thermique $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

► λ_e : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

► λ_p : phonons (vibrations réseau atomique)

Relation entre conductivités thermique et électrique



cond. thermique $\lambda = \lambda_e + \lambda_p$

► λ_e : porteurs de charges (électrons)

$$\lambda_e = LT\sigma$$

► λ_p : phonons (vibrations réseau atomique)

→ Les matériaux bons conducteurs thermiques/isolants électriques sont rares (diamant, AlN, Si₃N₄, Al₂O₃)

Isolants/conducteurs électrique/thermique

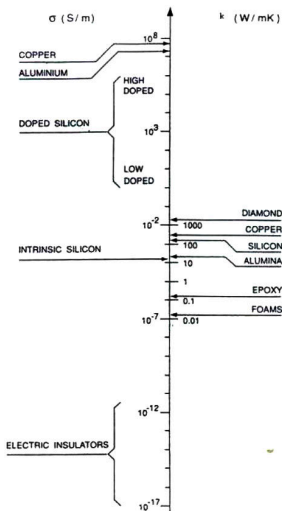
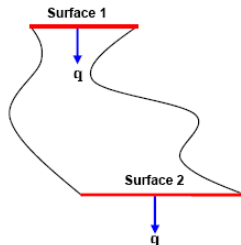


Figure 1: Comparison between electrical and thermal conductivities

Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lanceau, ECPE Workshop on advanced cooling, 20-21 November 2008, Delft.

- ▶ La conductivité électrique peut varier de plus de 20 décades
 - ▶ Le courant passe dans les conducteurs et pas à côté !
 - ▶ La représentation circuit est bien adaptée
- ▶ Pour la conductivité thermique, c'est 4 à 5 décades
 - ▶ Approximation circuit utilisable avec précautions

Représentation circuit thermique

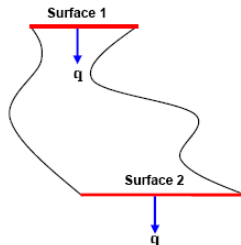


Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lansance, ECPE Workshop on advanced cooling, 20-21 November 2008, Delft.

On peut définir une R_{Th} entre 1 et 2 si :

- ▶ Les surfaces 1 et 2 sont isothermes
- ▶ Un flux thermique identique traverse les deux surfaces (conservation)

Représentation circuit thermique



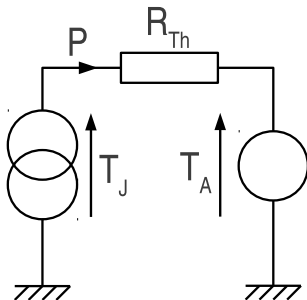
On peut définir une R_{Th} entre 1 et 2 si :

- ▶ Les surfaces 1 et 2 sont isothermes
- ▶ Un flux thermique identique traverse les deux surfaces (conservation)

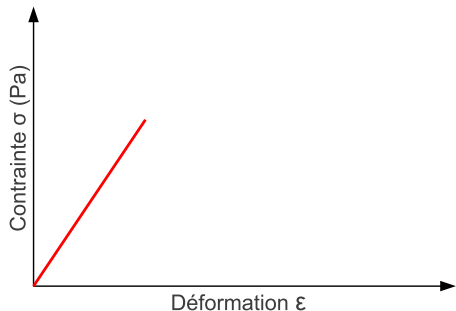
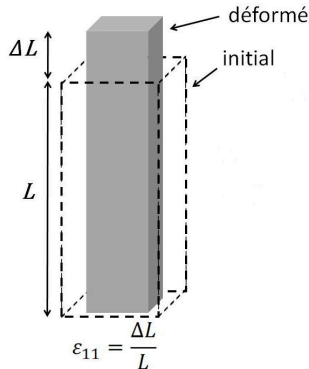
Source : Heat Spreading : not a trivial issue, C. Lansance, ECPE Workshop on advanced cooling, 20-21 November 2008, Delft.

On peut alors définir une représentation circuit

- ▶ Les températures sont des efforts (tensions)
- ▶ Les puissances dissipées des flux (courants)
- ▶ $T_J = T_A + R_{Th} \times P$



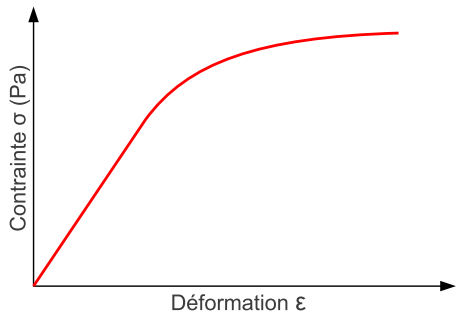
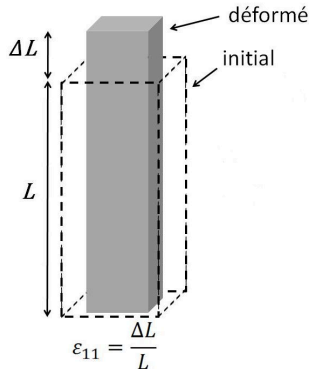
Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ Accumulation de la déformation menant à la rupture

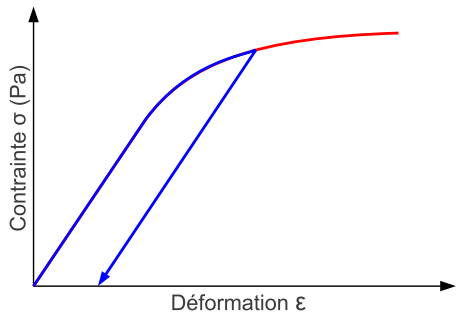
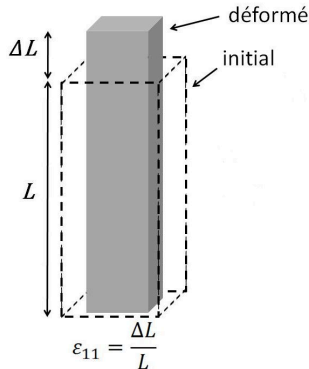
Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ Accumulation de la déformation menant à la rupture

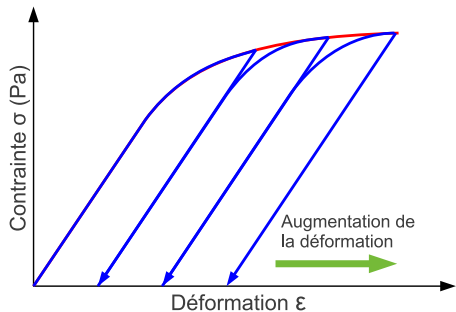
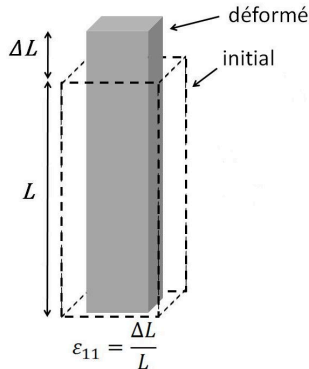
Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ Accumulation de la déformation menant à la rupture

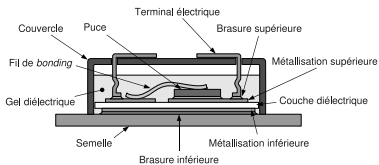
Un peu de mécanique...



Source : thèse L. Pietranico, <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00543040/fr/>

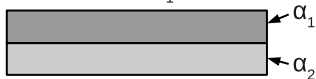
- ▶ Déformation élastique (réversible)
- ▶ Déformation plastique (irréversible)
- ▶ Apparition d'une déformation résiduelle
- ▶ Accumulation de la déformation menant à la rupture

Effet des coefficients de dilatation



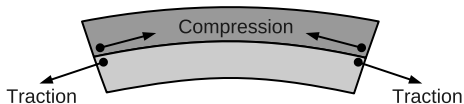
- ▶ α en ppm/K
- ▶ $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

Température de repos T_1

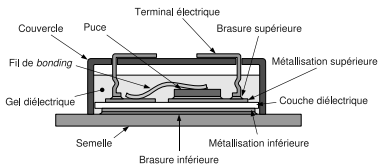


$$\alpha_1 > \alpha_2$$

$T_2 > T_1$

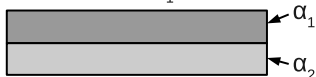


Effet des coefficients de dilatation

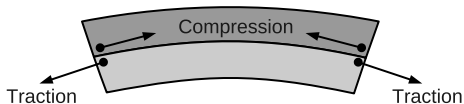


- ▶ α en ppm/K
- ▶ $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

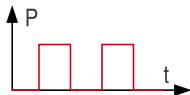
Température de repos T_1



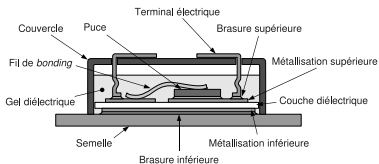
$T_2 > T_1$



Fonctionnement cyclique

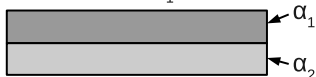


Effet des coefficients de dilatation

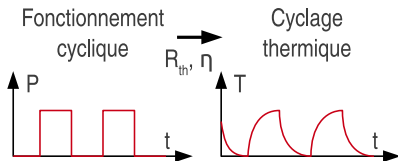
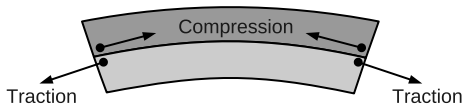


- ▶ α en ppm/K
- ▶ $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

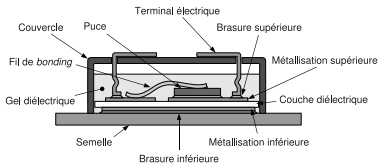
Température de repos T_1



$T_2 > T_1$

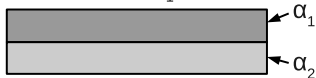


Effet des coefficients de dilatation

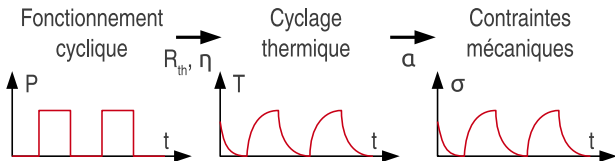
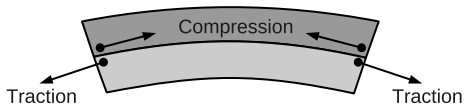


- ▶ α en ppm/K
- ▶ $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

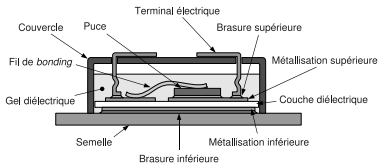
Température de repos T_1



$T_2 > T_1$



Effet des coefficients de dilatation

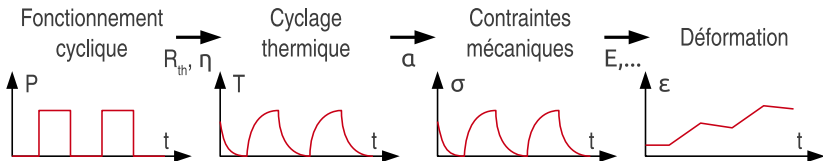
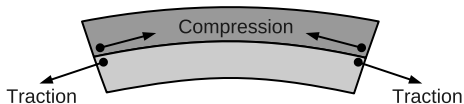


- ▶ α en ppm/K
- ▶ $3 \cdot 10^{-6} < \alpha < 20 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
- ▶ la température génère des contraintes mécaniques

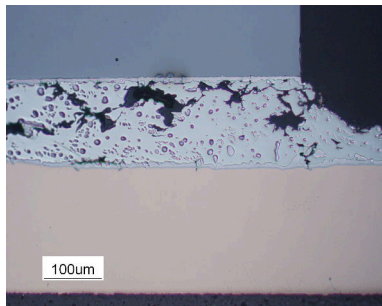
Température de repos T_1



$T_2 > T_1$



Effet des contraintes thermo-mécaniques

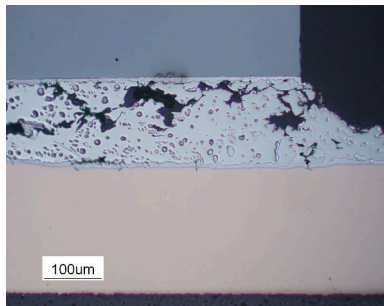


Source : Université de Nottingham

Brasure puce-substrat

- ▶ Puce en silicium (3 ppm/K)
- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Brasure tendre concentrant la fatigue

Effet des contraintes thermo-mécaniques



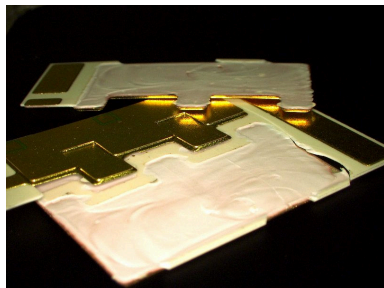
Source : Université de Nottingham

Brasure puce-substrat

- ▶ Puce en silicium (3 ppm/K)
- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Brasure tendre concentrant la fatigue

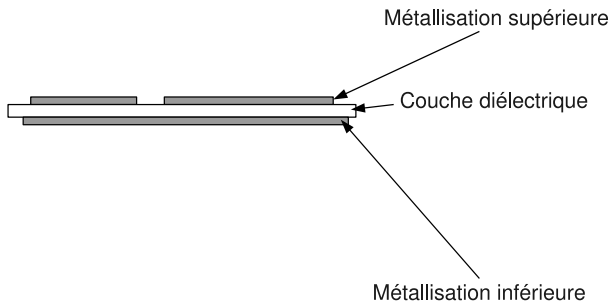
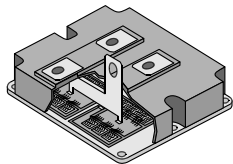
Substrat céramique métallisé

- ▶ Conducteur en cuivre (17 ppm/K)
- ▶ Substrat céramique (6 ppm/K)
- ▶ Fissuration « conchoïdale » de la céramique

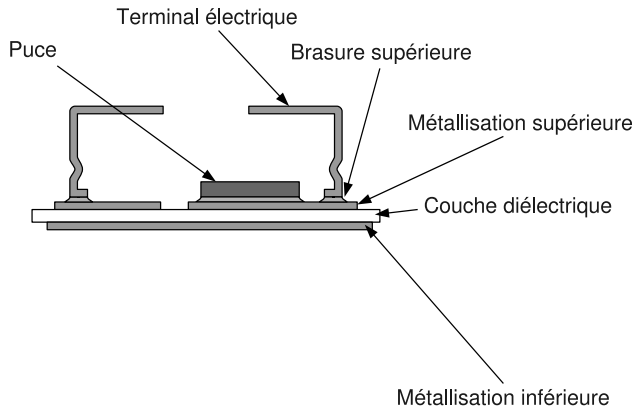
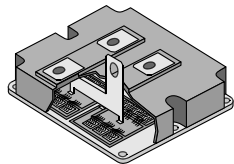


Source : Université de Nottingham

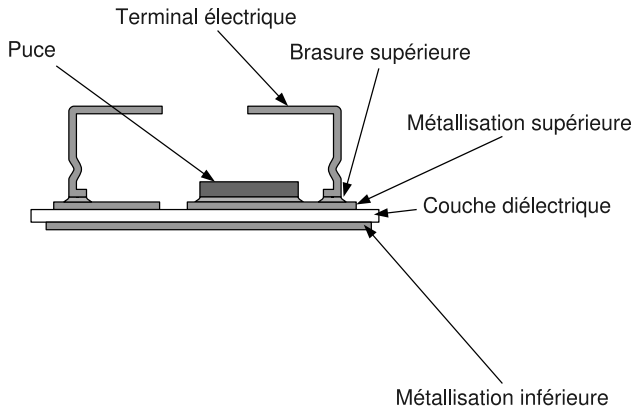
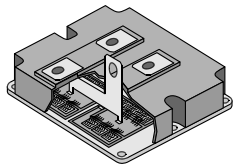
Coupe d'un module de puissance



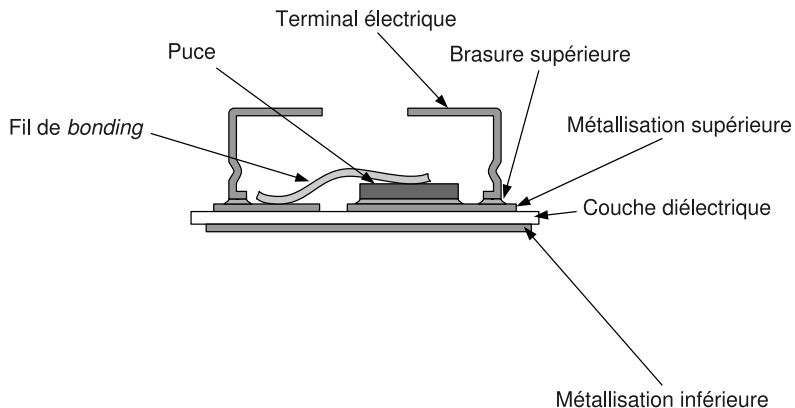
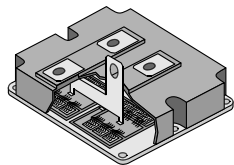
Coupe d'un module de puissance



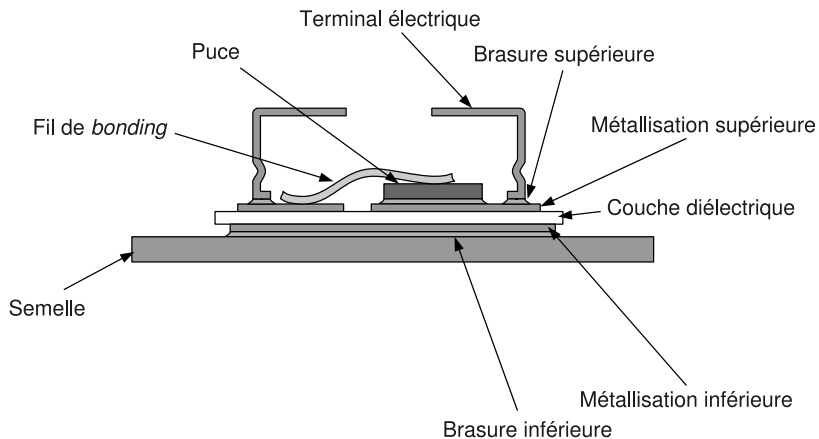
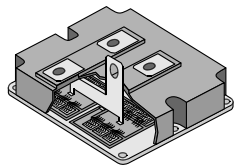
Coupe d'un module de puissance



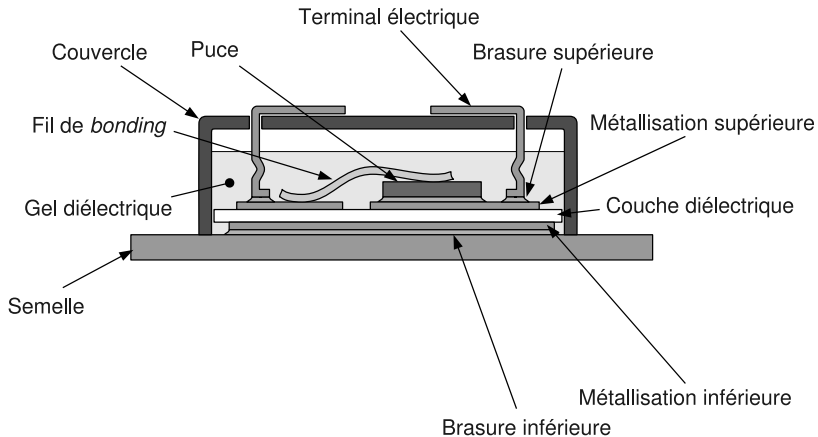
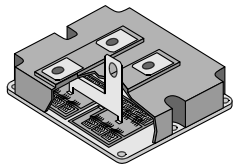
Coupe d'un module de puissance



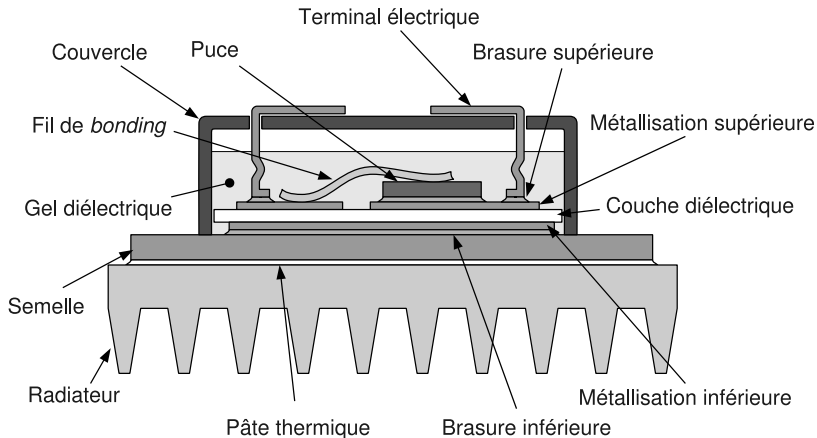
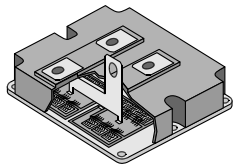
Coupe d'un module de puissance

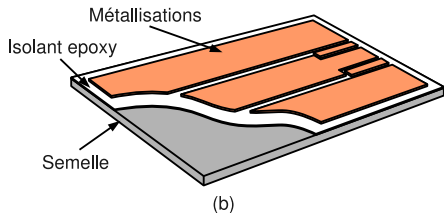
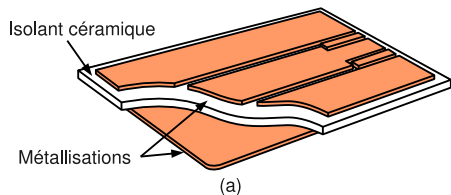


Coupe d'un module de puissance



Coupe d'un module de puissance





Plusieurs technologies :

► Les substrats céramiques (DBC, DBA, ...)

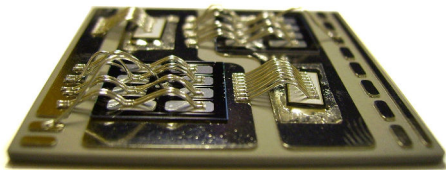
- Céramique (0,3 à 1 mm)
- Cuivre (0,1 à 0,3 mm)
- Bonnes performances thermiques et électriques
- Cher

► Les Substrats Métalliques Isolés (SMI)

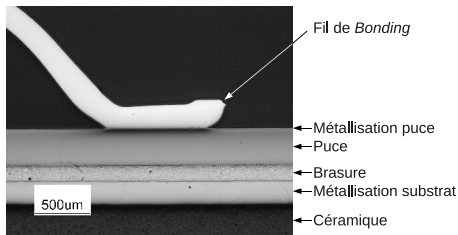
- Aluminium (1 à 3 mm)
- Isolant (0,1 mm)
- Cuivre (0,035 à 0,2 mm)
- Performances moyennes
- Coef. de dilatation plus fort
- Moins cher
- Limité à $< 175^{\circ}\text{C}$

Fils de *bonding*

- ▶ Fils épais (100 à 400 μm), en aluminium
- ▶ Mise en parallèle pour réduire la résistance
- ▶ Soudure ultrasonique (faible échauffement)
- ▶ Évolutions vers les fils de cuivre, les rubans. . .

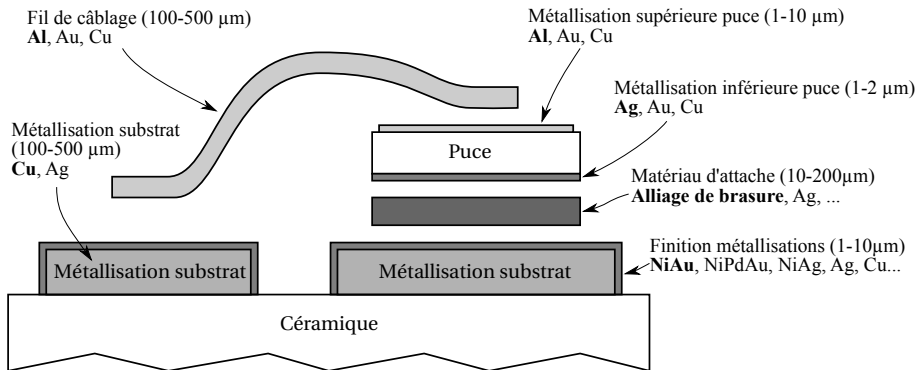


Source : Université Nottingham



Source : Université Nottingham

Finitions métalliques du packaging



En gras : les finitions et métaux les plus courants

Ces finitions visent à :

- ▶ protéger de l'oxydation, la diffusion d'espèces chimiques ;
- ▶ la compatibilité avec les procédés d'interconnexion.

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

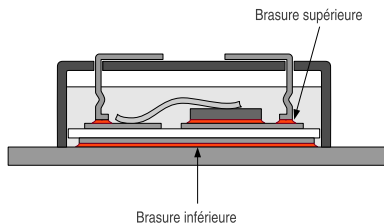
Généralités Packaging

Attache de composants

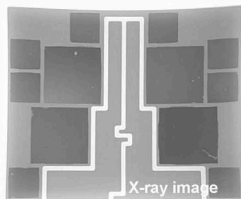
Circuits imprimés

Conclusions

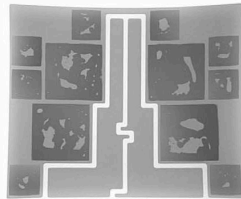
- ▶ Brasures réalisées au four
- ▶ Utilisation de pâte à braser, de preforms
- ▶ Nombreux alliages disponibles
- ▶ Tendance au “sans plomb” (RoHS)
- ▶ Habituellement deux étapes de brasure :
 - ▶ Puces et connecteurs sur substrat
 - ▶ Substrat sur semelle



Formic Acid atmosphere prior reflow versus non



Formic Acid atmosphere prior reflow



non Formic Acid atmosphere

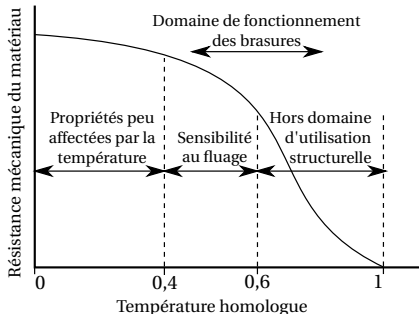
void free solder joints even without vacuum prior and during reflow

Source : Reflow Soldering Technology for large die area Power Electronics, Matthias Hutter, Microcar, Leipzig, 21 juin 2005

Risque de vides sur les brasures de grande surface :

- ▶ Augmentation de la résistance thermique
- ▶ Apparition de points chauds
- ▶ Peut être réduit par utilisation d'atmosphères spécifiques durant le process (vide, gaz actifs. . .)

Les brasures – limites de fonctionnement



Source: http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion (T_M)

▶ Température homologue :

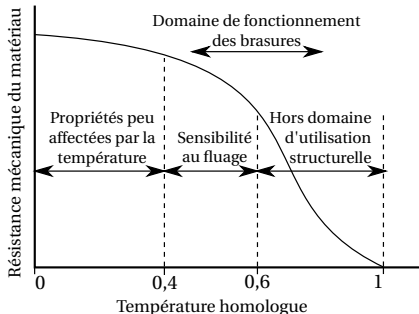
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$

▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse

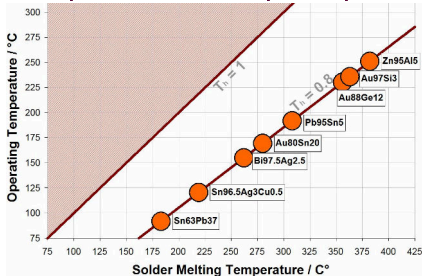
▶ ex : $T_M=300^\circ\text{C}$ (573 K), pour $T_H=0.8$: $T_O=185^\circ\text{C}$

▶ ex : $T_M=183^\circ\text{C}$ (fil de brasure standard), pour $T_H=0.8$: $T_O=92^\circ\text{C}$

Les brasures – limites de fonctionnement



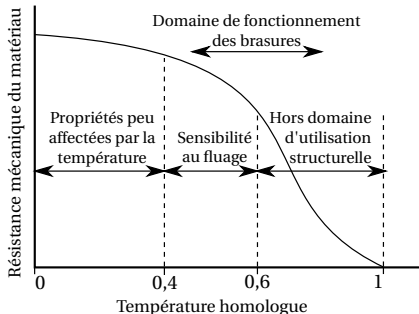
Source : http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/



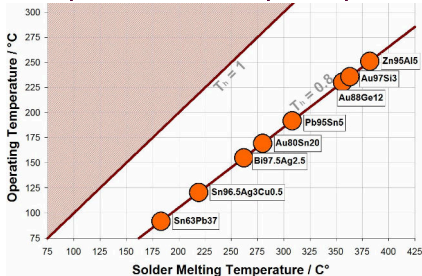
Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion (T_M)
- ▶ Température homologue :
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse
 - ▶ ex : $T_M=300\text{ °C}$ (573 K), pour $T_H=0.8$: $T_O=185\text{ °C}$
 - ▶ ex : $T_M=183\text{ °C}$ (fil de brasure standard), pour $T_H=0.8$: $T_O=92\text{ °C}$

Les brasures – limites de fonctionnement



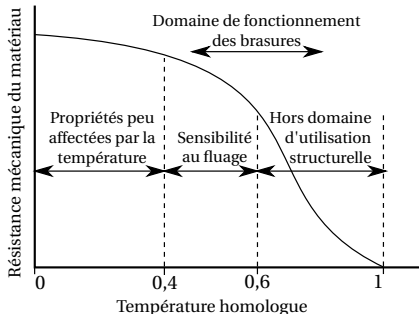
Source : http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/



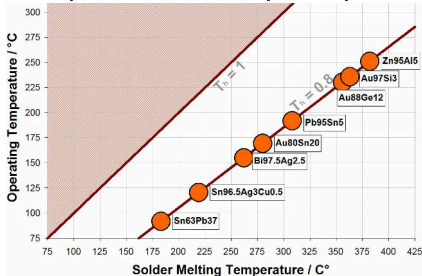
Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion (T_M)
- ▶ Température homologue :
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse
- ▶ ex : $T_M=300\text{ °C}$ (573 K), pour $T_H=0.8$: $T_O=185\text{ °C}$
- ▶ ex : $T_M=183\text{ °C}$ (fil de brasure standard), pour $T_H=0.8$: $T_O=92\text{ °C}$

Les brasures – limites de fonctionnement



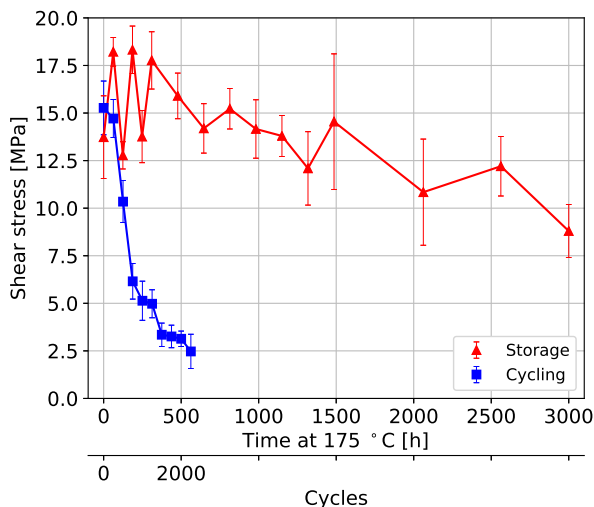
Source : http://www.am1.ac.uk/courses/topics/0123_mpm/



Source : Power Semiconductor Joining through Sintering of Silver Nanoparticles...
M.Knoerr et al, CIPS 2010

- ▶ Les propriétés mécaniques diminuent avec la température
- ▶ Plus aucune tenue à la température de fusion (T_M)
- ▶ Température homologue :
$$T_H = \frac{T_O[K]}{T_M[K]}$$
- ▶ Limite de fonctionnent fiable des brasures basse
- ▶ ex : $T_M=300\text{ °C}$ (573 K), pour $T_H=0.8$: $T_O=185\text{ °C}$
- ▶ ex : $T_M=183\text{ °C}$ (fil de brasure standard), pour $T_H=0.8$: $T_O=92\text{ °C}$

Vieillesse haute température de brasures [10]

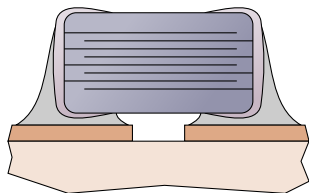


Conditions : cyclage -55/175 °C (IMS), stockage 175 °C(Ampère)

- ▶ Dégradation rapide en cyclage (arrêt après 2250 cycles)
- ▶ Lente diminution en stockage (-40 % après 3000 h)

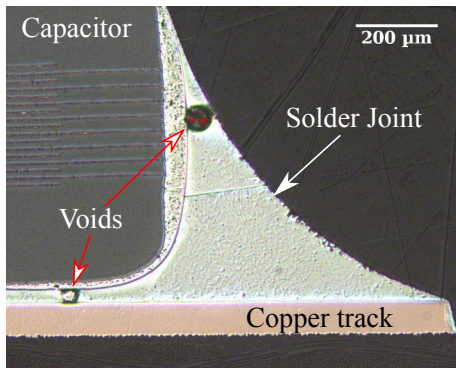
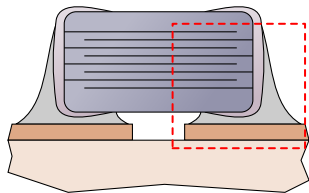
Vieillesse haute température de brasures [10] – 2

- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
 - ▶ Plus de vacuoles
 - ▶ Amorce de fissuration
 - ▶ Rugosification de surface



Vieillesse haute température de brasures [10] – 2

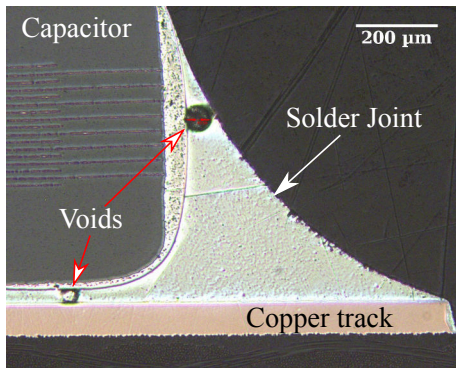
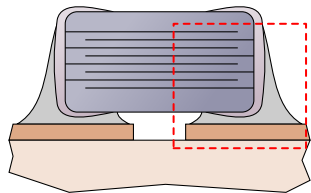
- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
 - ▶ Plus de vacuoles
 - ▶ Amorce de fissuration
 - ▶ Rugosification de surface



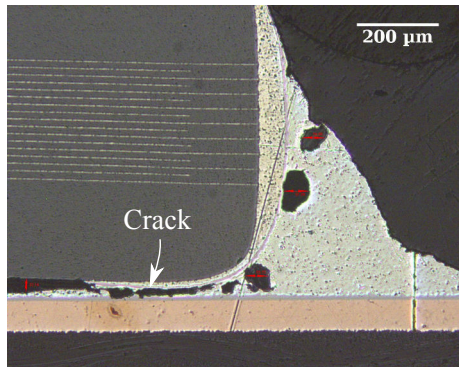
$t=0$

Vieillesse haute température de brasures [10] – 2

- ▶ Vacuoles dans le joint dès le début
- ▶ Après cyclage (750 cycles) :
 - ▶ Plus de vacuoles
 - ▶ Amorce de fissuration
 - ▶ Rugosification de surface

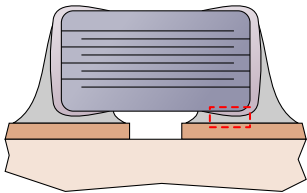


t=0



750 cycles (-55/+175 °C)

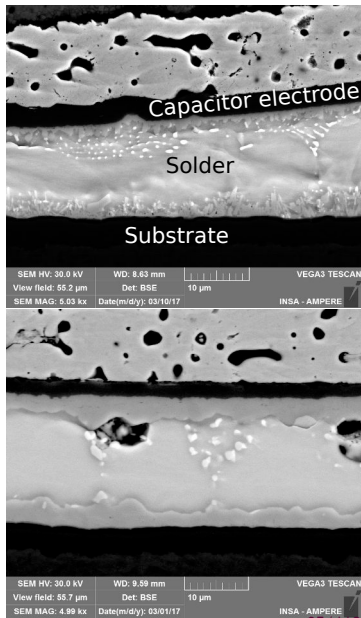
Vieillessement haute température de brasures [10] – 3



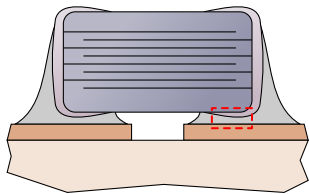
Stockage 175 °C, 310 h

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Pas de fissuration

Haut droit : stockage, bas droit : stockage.



Vieillessement haute température de brasures [10] – 3



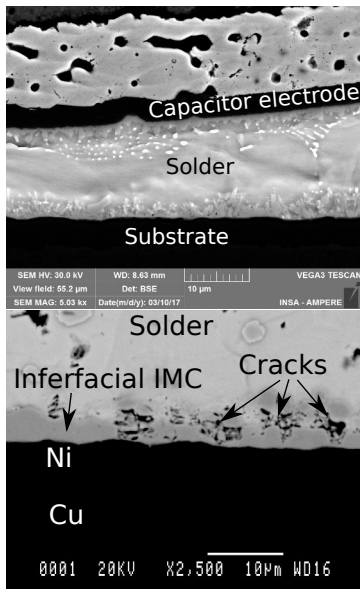
Stockage 175 °C, 310 h

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Pas de fissuration

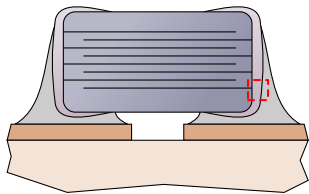
Cyclage -55/+175 °C, 1500 cycles

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Fissures entre les IMC et la brasure
- ▶ S'observe aussi côté condensateur

Haut droit : stockage, bas droit : cyclage.



Vieillessement haute température de brasures [10] – 3



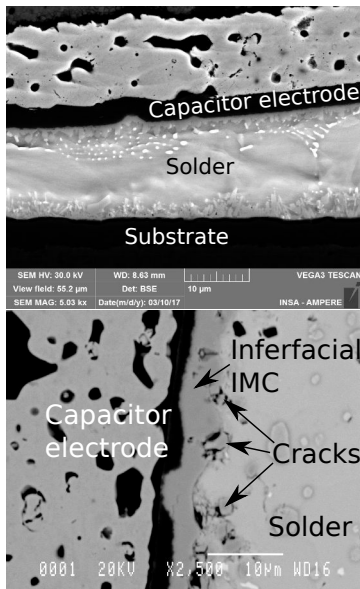
Stockage 175 °C, 310 h

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Pas de fissuration

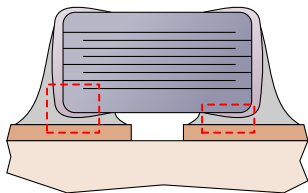
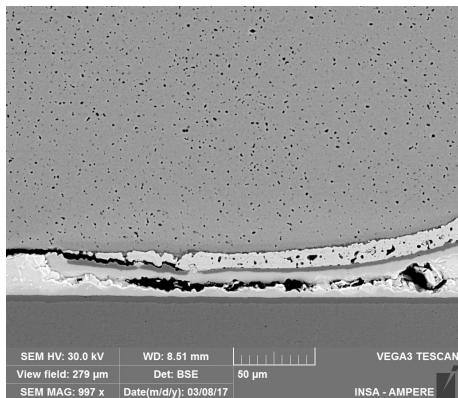
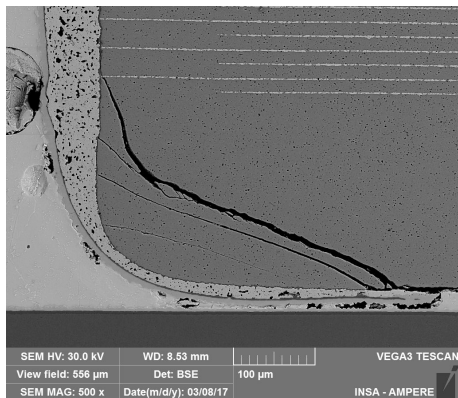
Cyclage -55/+175 °C, 1500 cycles

- ▶ Les IMC interfaciaux sont continus
- ▶ Fissures entre les IMC et la brasure
- ▶ S'observe aussi côté condensateur

Haut droit : stockage, bas droit : cyclage.



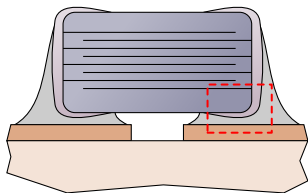
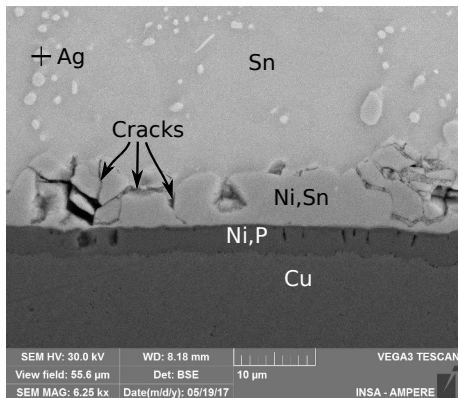
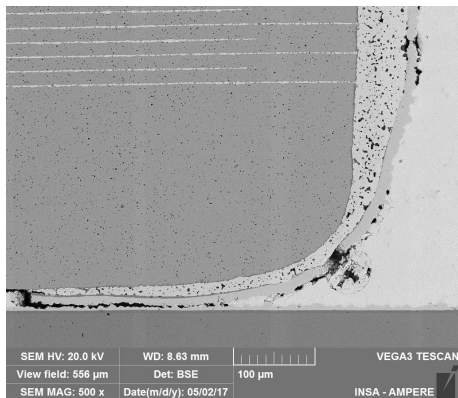
Vieillesse haute température de brasures [10] – 4



stockage 175 °C, 1000 h

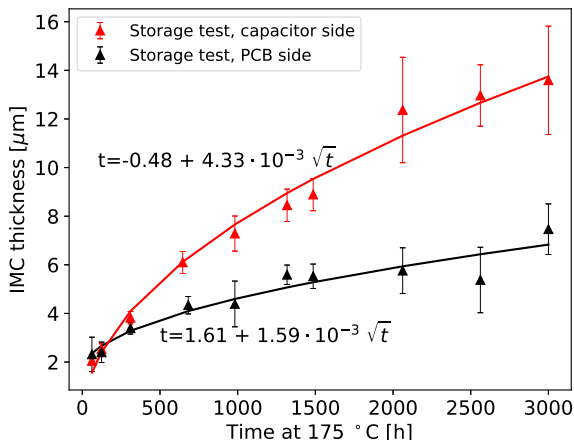
- ▶ Les IMC interfaciaux s'épaississent
- ▶ Ils prennent tout l'espace sous le condensateur
- ▶ Des fissures apparaissent

Vieillesse haute température de brasures [10] – 4



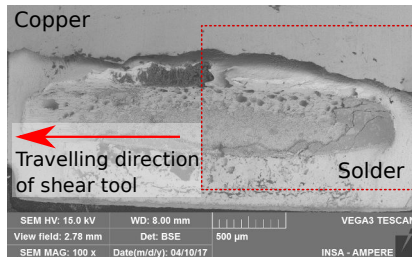
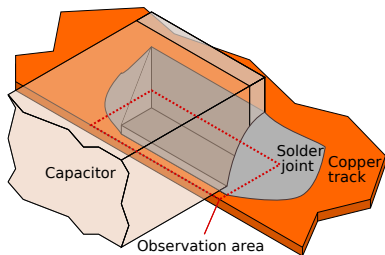
Stockage 175 °C, 2562 h

- ▶ Les IMC croissent là où c'est possible
- ▶ Les fissures continuent à se propager
- ▶ Elles se produisent aussi dans les IMC



- ▶ Mesure sur images MEB, en 40 points, sur 4 zones
- ▶ Par endroits, la croissance est limitée par les fissures
- ▶ Finition du PCB : Ni/Au (ENIG), des condensateurs : Ni/Sn

Vieillesse haute température de brasures [10] – 6



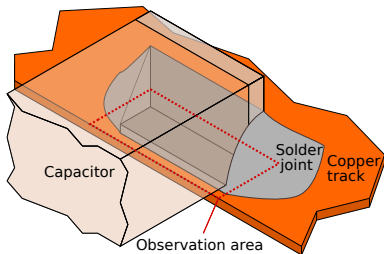
- Tenue cisaillement : 10 MPa, après 2062 h, $\approx 70\%$ de t_0

A : Sous le condensateur : fissuration continue

B : Côté du joint : larges vacuoles contact par endroits, (ex. coin)

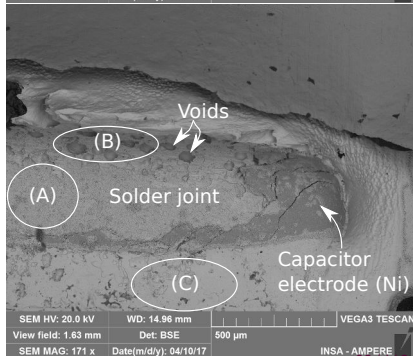
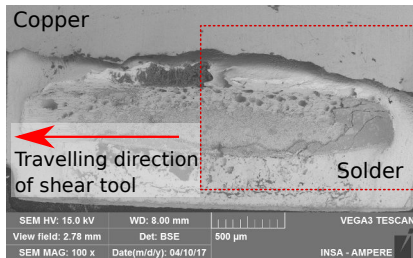
C : Sous le condensateur : aucune attache

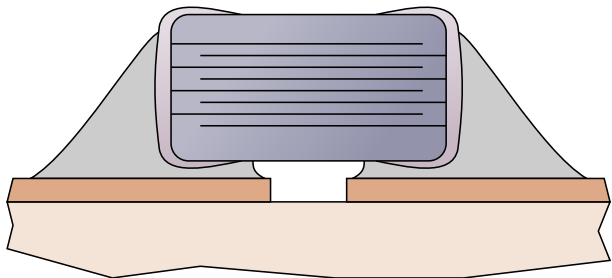
Vieillesse haute température de brasures [10] – 6



- Tenue cisaillement : 10 MPa, après 2062 h, $\approx 70\%$ de t_0

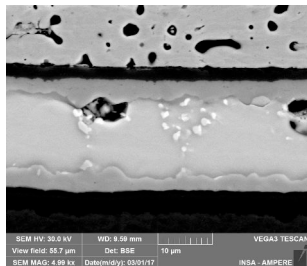
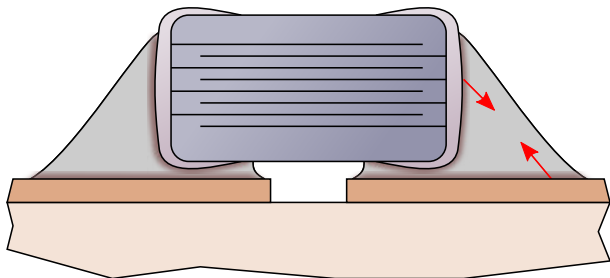
- A : Sous le condensateur : fissuration continue
- B : Côté du joint : larges vacuoles contact par endroits, (ex. coin)
- C : Sous le condensateur : aucune attache





Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
 - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
 - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
 - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
 - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Solution possible :
 - ▶ « Piédestal » de brasure plus épais
 - ▶ Nécessite des essais ou une modélisation mécanothermique

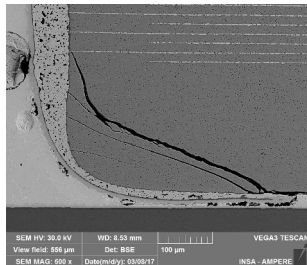
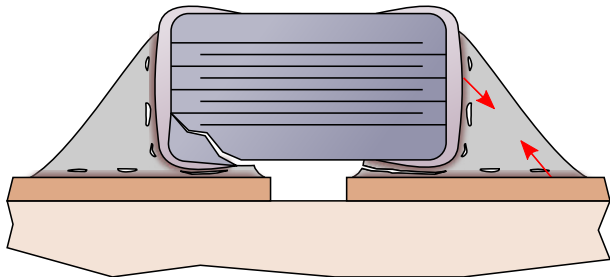


Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
 - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
 - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
 - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
 - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Solution possible :

▶ « Piédestal » de brasure plus épais

▶ Réalisation des essais au www.modsim.com

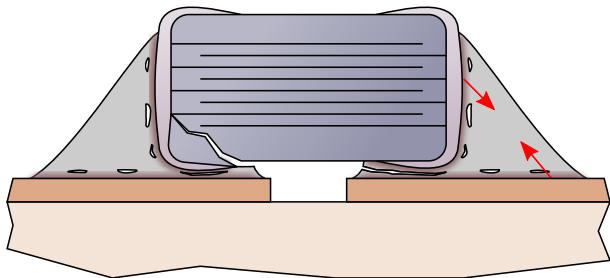


Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
 - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
 - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
 - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
 - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Solution possible :

▶ « Piédestal » de brasure plus épais

▶ Nécessité des essais de type modélisation numérique



Mécanismes du vieillissement isotherme :

- ▶ Les IMC interfaciaux croissent
 - ▶ IMC plus denses que la brasure → le joint se contracte
 - ▶ Augmentation des contraintes résiduelles dans le joint
- ▶ Au cours de la croissance des IMC
 - ▶ Des fissures se propagent à l'interface IMC/brasure
 - ▶ Peuvent également se propager dans le condensateur
- ▶ Solution possible :
 - ▶ « Piédestal » de brasure plus épais
 - ▶ Nécessite des essais ou une modélisation mécano-thermique

- ▶ À 175 °C, les joints de brasure SAC 305 se dégradent rapidement
 - ▶ Particulièrement vrai en cyclage (2000 cycles max.)
 - ▶ Vitesse de croissance des IMC compatible avec [11] :
 - ▶ Pas de nouveau mécanisme de détérioration
 - ▶ La dégradation est plus rapide à 175 °C qu'à 125 °C ou 150 °C.
 - ▶ Concernant la tenue mécanique :
 - ▶ La fissuration est observée en cyclage et en stockage
 - ▶ Elle est plus rapide en cyclage
- La SAC 305 fond à 217 °C, mais même sans cyclage, elle ne peut fonctionner longtemps à 175 °C...

- ▶ À 175 °C, les joints de brasure SAC 305 se dégradent rapidement
 - ▶ Particulièrement vrai en cyclage (2000 cycles max.)
 - ▶ Vitesse de croissance des IMC compatible avec [11] :
 - ▶ Pas de nouveau mécanisme de défaillance
 - ▶ La dégradation est plus rapide à 175 °C qu'à 125 °C ou 150 °C.
 - ▶ Concernant la tenue mécanique :
 - ▶ La fissuration est observée en cyclage et en stockage
 - ▶ Elle est plus rapide en cyclage
- La SAC 305 fond à 217 °C, mais même sans cyclage, elle ne peut fonctionner longtemps à 175 °C...

- ▶ À 175 °C, les joints de brasure SAC 305 se dégradent rapidement
 - ▶ Particulièrement vrai en cyclage (2000 cycles max.)
 - ▶ Vitesse de croissance des IMC compatible avec [11] :
 - ▶ Pas de nouveau mécanisme de défaillance
 - ▶ La dégradation est plus rapide à 175 °C qu'à 125 °C ou 150 °C.
 - ▶ Concernant la tenue mécanique :
 - ▶ La fissuration est observée en cyclage et en stockage
 - ▶ Elle est plus rapide en cyclage
- La SAC 305 fond à 217 °C, mais même sans cyclage, elle ne peut fonctionner longtemps à 175 °C...

- ▶ À 175 °C, les joints de brasure SAC 305 se dégradent rapidement
 - ▶ Particulièrement vrai en cyclage (2000 cycles max.)
 - ▶ Vitesse de croissance des IMC compatible avec [11] :
 - ▶ Pas de nouveau mécanisme de défaillance
 - ▶ La dégradation est plus rapide à 175 °C qu'à 125 °C ou 150 °C.
 - ▶ Concernant la tenue mécanique :
 - ▶ La fissuration est observée en cyclage et en stockage
 - ▶ Elle est plus rapide en cyclage
- **La SAC 305 fond à 217 °C, mais même sans cyclage, elle ne peut fonctionner longtemps à 175 °C...**

Objectif : décorrélérer $T_{process}$ and $T_{fonctionnement}$.

- ▶ Brasure : $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$ par définition.
- ▶ Frittage :
 - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide);
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$.
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
 - ▶ fusion d'un matériau de liaison;
 - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide;
 - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion;
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$ pour le composé final.

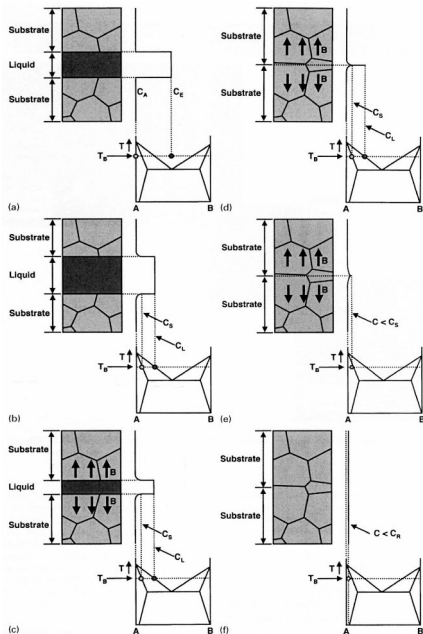
Objectif : décorrélérer $T_{process}$ and $T_{fonctionnement}$.

- ▶ Brasure : $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$ par définition.
- ▶ Frittage :
 - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide) ;
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$.
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
 - ▶ fusion d'un matériau de liaison ;
 - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide ;
 - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion ;
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$ pour le composé final.

Objectif : décorrélérer $T_{process}$ and $T_{fonctionnement}$.

- ▶ Brasure : $T_{process} > T_{fusion} > T_{fonctionnement}$ par définition.
- ▶ Frittage :
 - ▶ phénomène de diffusion (habituellement à l'état solide) ;
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$.
- ▶ Soudure en phase liquide transitoire (TLPB, SLID) :
 - ▶ fusion d'un matériau de liaison ;
 - ▶ diffusion du liquide dans un matériau solide ;
 - ▶ formation d'un nouveau composé à haut point de fusion ;
 - ▶ $T_{process} < T_{fusion}$ pour le composé final.

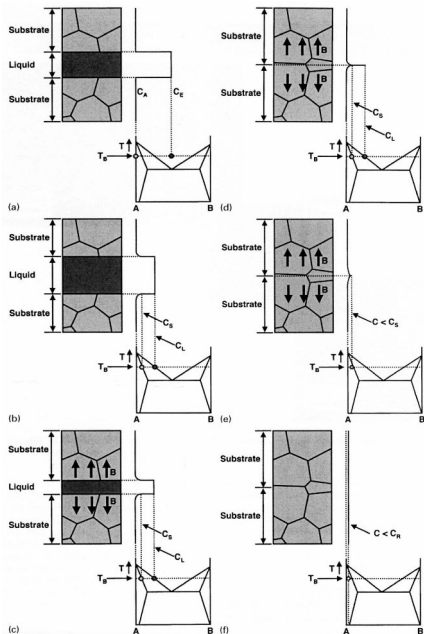
Soudure en phase liquide transitoire



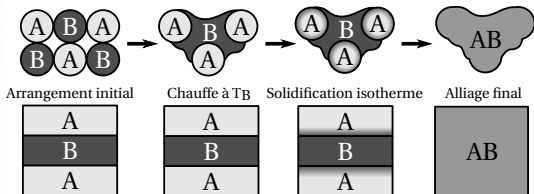
- ▶ Matériau fusible : Sn, In
- ▶ Matériau substrat : Cu, Ag, Au
- ▶ Épaisseurs :
 - ▶ Substrat : dizaines de microns
 - ▶ Couche fusible : microns
- ▶ Alternative : utilisation de poudres
- ▶ Mise au point complexe (IMC)

Source image de gauche : [12] ; image ci-dessus [13]

Soudure en phase liquide transitoire



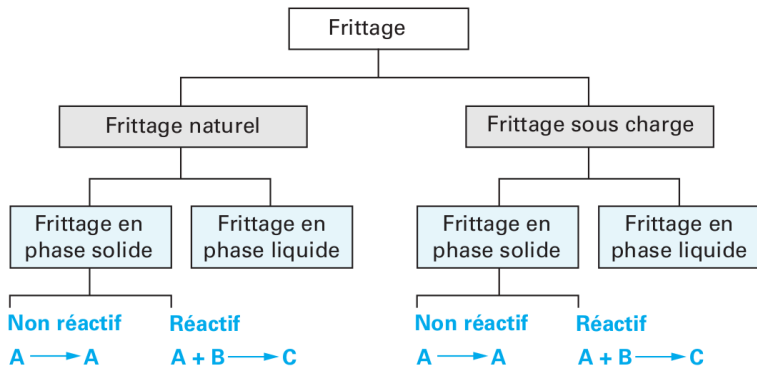
- ▶ Matériau fusible : Sn, In
- ▶ Matériau substrat : Cu, Ag, Au
- ▶ Épaisseurs :
 - ▶ Substrat : dizaines de microns
 - ▶ Couche fusible : microns
- ▶ Alternative : utilisation de poudres
- ▶ Mise au point complexe (IMC)



Source image de gauche : [12] ; image ci-dessus [13]



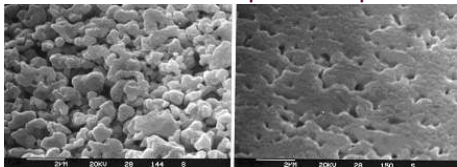
Le frittage, une alternative à la brasure



Source : Article Frittage techniques de l'ingénieur [14]

Dans tous les cas, il s'agit de former un **solide** par création de **ponts entre des particules sans atteindre la température de fusion** du constituant principal.

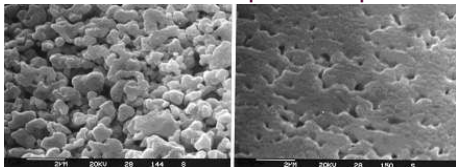
Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

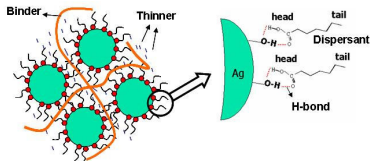
Attache de puce par frittage d'argent

Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

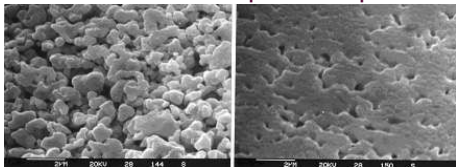
On rajoute de quoi faire une pâte



Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005

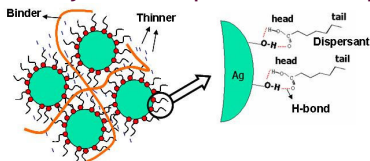
Attache de puce par frittage d'argent

Densification sans phase liquide



Göbl, C. et al "Low temperature sinter technology Die attachment for automotive power electronic applications" proc of APE, 2006

On rajoute de quoi faire une pâte



Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005

Les paramètres principaux du procédé

- ▶ La température
- ▶ Le temps
- ▶ La pression

Mais aussi :

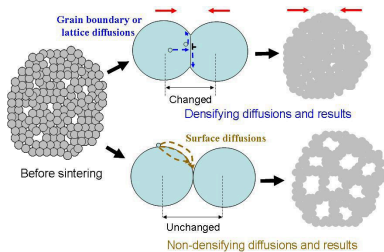
- ▶ Les conditions de séchage
- ▶ Les rampes de montée en température
- ▶ L'atmosphère de frittage
- ▶ La taille de puce
- ▶ ...

Quelques problèmes qu'on peut rencontrer

- ▶ Composés organiques mal évacués
 - ▶ Leur ébullition cause des vides
 - ▶ Il faut les évacuer doucement et complètement
- ▶ Mauvaise densification
 - ▶ Manque d'uniformité, frittage partiel
 - ▶ Modification du profil de température
- ▶ Pas de phénomène de mouillage
 - ▶ Peu ou pas de tolérance aux erreurs d'alignement
 - ▶ L'écoulement de la pâte est contrôlé par la pression

Quelques problèmes qu'on peut rencontrer

- ▶ Composés organiques mal évacués
 - ▶ Leur ébullition cause des vides
 - ▶ Il faut les évacuer doucement et complètement
- ▶ Mauvaise densification
 - ▶ Manque d'uniformité, frittage partiel
 - ▶ Modification du profil de température

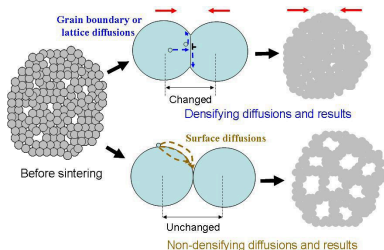


Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005

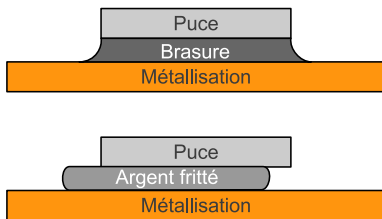
- ▶ Pas de phénomène de mouillage
 - ▶ Peu ou pas de tolérance aux erreurs d'alignement
 - ▶ L'écoulement de la pâte est contrôlé par la pression

Quelques problèmes qu'on peut rencontrer

- ▶ Composés organiques mal évacués
 - ▶ Leur ébullition cause des vides
 - ▶ Il faut les évacuer doucement et complètement
- ▶ Mauvaise densification
 - ▶ Manque d'uniformité, frittage partiel
 - ▶ Modification du profil de température



Bai, G. "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection" Thèse Virginia Tech., 2005



- ▶ Pas de phénomène de mouillage
 - ▶ Peu ou pas de tolérance aux erreurs d'alignement
 - ▶ L'écoulement de la pâte est contrôlé par la pression

Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
 - ▶ Thermique : 429 W/m.K
 - ▶ Électrique : $63 \cdot 10^6$ S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
 - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
 - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm².

Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
 - ▶ Thermique : 429 W/m.K
 - ▶ Électrique : $63 \cdot 10^6$ S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
 - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
 - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm².

Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
 - ▶ Thermique : 429 W/m.K
 - ▶ Électrique : $63 \cdot 10^6$ S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
 - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
 - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm².

Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
 - ▶ Thermique : 429 W/m.K
 - ▶ Électrique : $63 \cdot 10^6$ S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
 - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
 - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm².

Pourquoi fritter de l'argent ?

- ▶ Excellentes conductivités (argent massif)
 - ▶ Thermique : 429 W/m.K
 - ▶ Électrique : $63 \cdot 10^6$ S/m
- ▶ Peu toxique (pour l'homme)
- ▶ Pas de pénurie prévue
- ▶ Très bonne résistance à l'oxydation, utilisation courante en électronique
- ▶ (Relativement) Bon marché :
 - ▶ 0,45€ le gramme au 5/6/18
 - ▶ soit moins de 3 cts/puce de 1 cm².

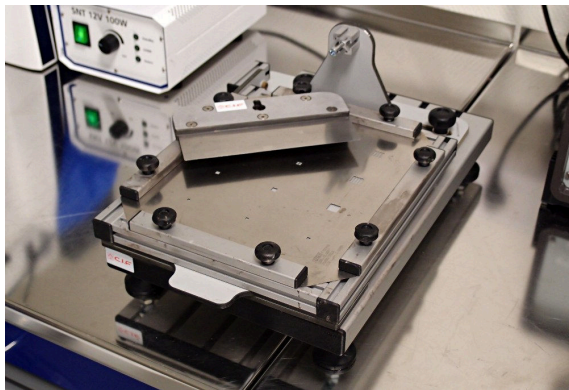
Dépôt de la pâte

Système très simple :

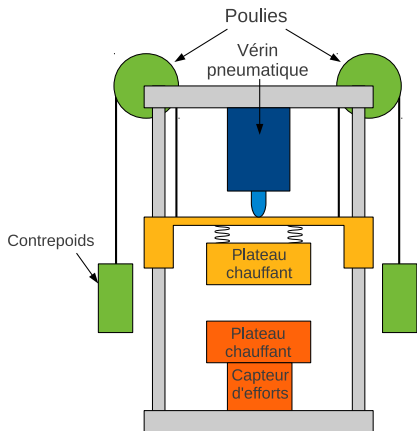
- ▶ Pochoirs métalliques, de 50 ou 100 μm
- ▶ Raclette manuelle.
- ▶ Taille \approx A4

Autres méthodes :

- ▶ Seringue
- ▶ film

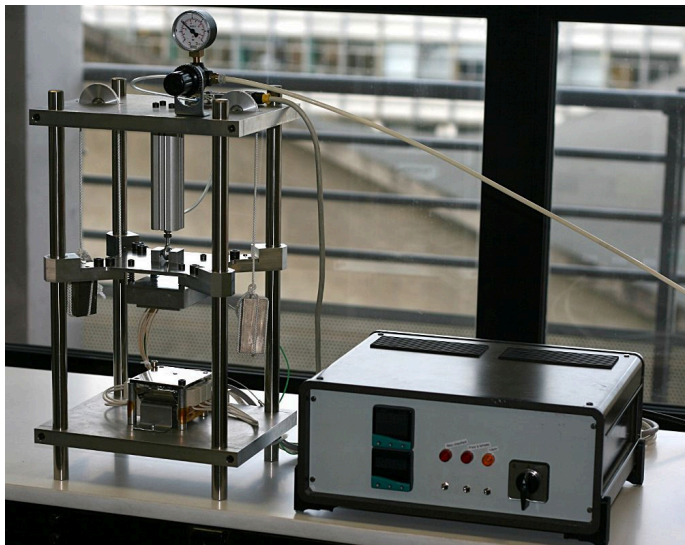


Développement spécifique d'une presse :

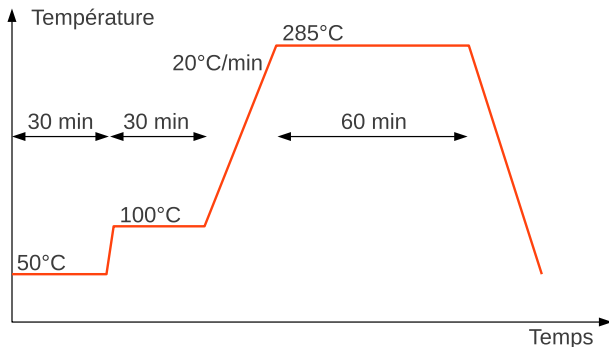


- ▶ Deux plateaux chauffants
 - ▶ Fonctionnement indépendant ou couplé
 - ▶ Rampes jusqu'à 50 °C/min
- ▶ Vérin pneumatique
 - ▶ Faible force mini (5 N avec contrepoids)
 - ▶ Force maxi : 1 kN
 - ▶ Déclenchement du vérin automatique
- ▶ Plateaux guidés pour le parallélisme
- ▶ Capteur de force

Frittage – 2



Frittage – 3, exemple de cycle



- ▶ Pression appliquée dès le début de cycle
- ▶ Procédure prévue pour les petites puces ($<3 \times 3 \text{ mm}^2$)
- ▶ Séchage long, rampe rapide
- ▶ Refroidissement naturel (1h)
- ▶ Plateaux en contact direct avec les puces
- ▶ Process sous air.



Source : Bai, G. [15]

Deux grandes classes de matériaux :

▶ Nanoparticules :

- ▶ Frittage basse ou sans pression
- ▶ Toxicité potentielle
- ▶ plus cher

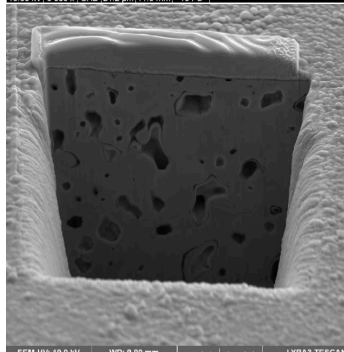
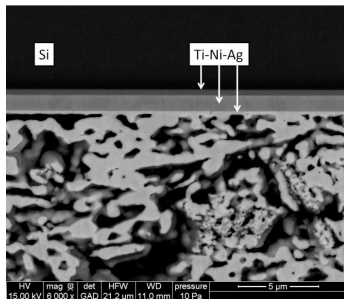
▶ Microparticules

- ▶ frittage forte pression (40 MPa), parfois sans pression possible
- ▶ peu cher, non toxique

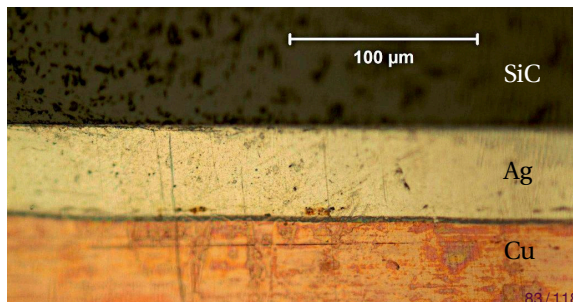
Mais il y a aussi des hybrides :

- ▶ additifs qui libèrent des nanoparticules pour favoriser le frittage
- ▶ Ajout de résine pour combler les vacuoles, fritter sans pression et permettre l'adhésion sur silicium

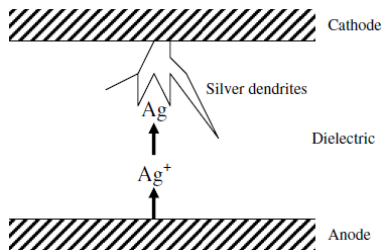
Attaches frittées [16, 17, 18]



- ▶ Procédé robuste (sous air)
- ▶ Robuste en cyclage et vieillissement
 - ▶ La haute température poursuit le frittage
 - ▶ Pas d'intermétalliques
 - ▶ Finition idéale : Ag
- ▶ Joints plus ou moins poreux
 - ▶ Attention à la mesure de porosité



Le frittage et la haute température : problème de migration



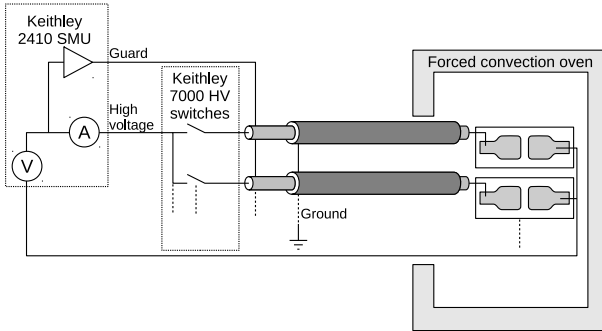
Source : Yang S et al. Initial stage of silver electrochemical migration degradation. Microelectron Reliab 2006;46(9) :1915–21.

Les atomes d'argent peuvent migrer en présence simultanée de :

- ▶ Haute température
- ▶ Oxygène/Humidité
- ▶ Champ électrique

L'argent peut alors former des filaments qui suivent le champ électrique, causant des courts-circuits !

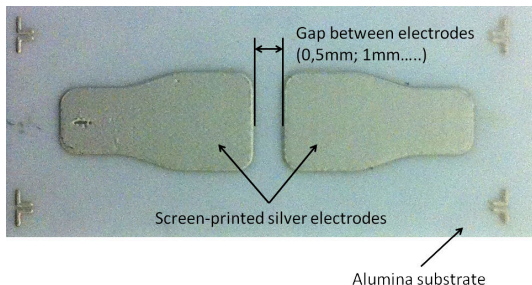
Banc de caractérisation pour la migration [19]



- ▶ Jusqu'à 10 échantillons polarisés simultanément et caractérisés régulièrement
- ▶ polarisation ≤ 1100 V, précision < 10 nA
- ▶ Tests effectués à 300 °C

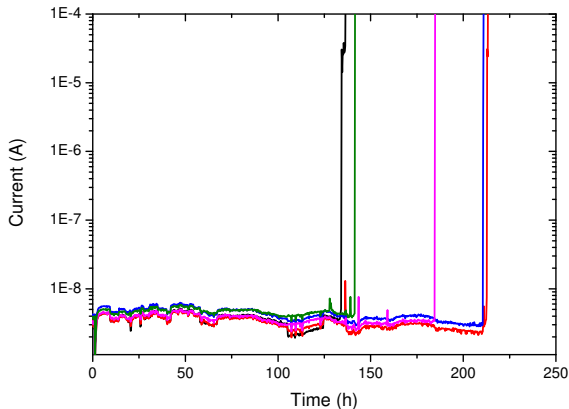


Migration – Véhicules de test

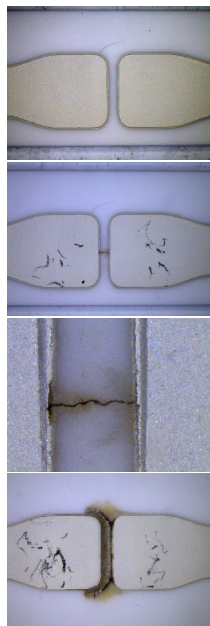


- ▶ Sérigraphie de pâte d'argent sur alumine, frittage 300 °C
- ▶ Espace entre électrodes : 0.5, 1, 1.5, 2 mm
- ▶ Encapsulation :
 - ▶ Sans protection
 - ▶ Protégé avec une couche de 20 μm de parylene HT
- ▶ 5 échantillons par configuration

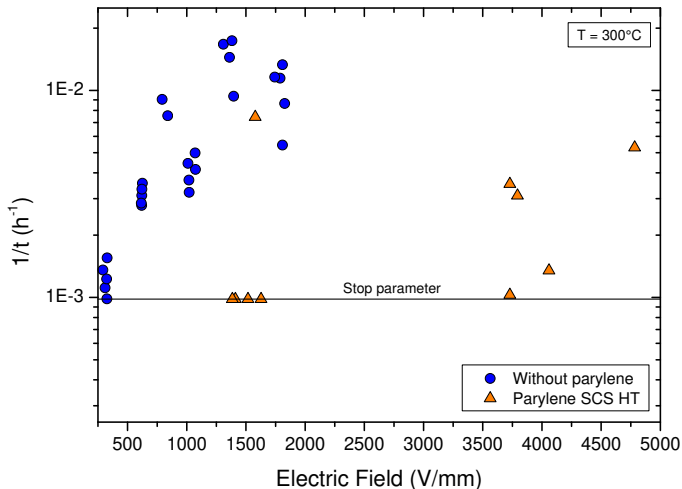
Migration – Resultats : Échantillons non protégés



- ▶ Le courant reste négligeable jusqu'au court-circuit
- ▶ Grande variation entre échantillons identiques :
 - ▶ Forme des filaments
 - ▶ Temps avant défaillance



Migration – Résultats



- ▶ Faible temps avant défaillance sans protection (100–1000 h)
- ▶ Amélioration nette avec l'encapsulation parylène
- ▶ Essais stoppés après 1000 h si pas de défaillance

- ▶ La brasure est intrinsèquement limitée
($T_{process} > T_{utilisation}$)
 - ▶ Problème de la température homologue
- ▶ Deux solutions alternatives :
 - ▶ TLPB : prometteur, bon marché, mais complexe à mettre en œuvre
 - ▶ Frittage :

- ▶ La brasure est intrinsèquement limitée
($T_{process} > T_{utilisation}$)
 - ▶ Problème de la température homologue
- ▶ Deux solutions alternatives :
 - ▶ TLPB : prometteur, bon marché, mais complexe à mettre en œuvre
 - ▶ Frittage :
 - ▶ mise en œuvre aisée ;
 - ▶ relativement peu cher ;
 - ▶ compatible avec les finitions existantes ;
 - ▶ chimiquement stable ;
 - ▶ la migration reste un problème mineur, non rencontré sur des échantillons réalistes ;
 - ▶ en cours de développement à l'échelle industrielle.

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

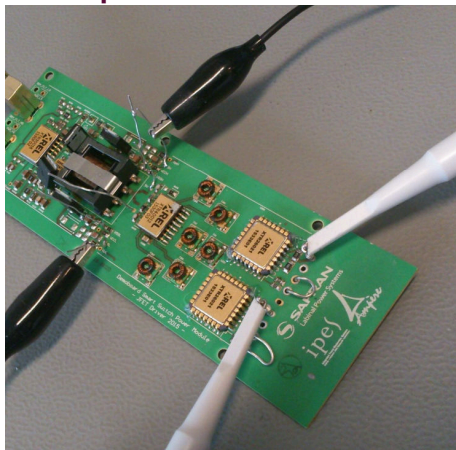
Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

Application : driver haute température pour des MOSFETs SiC

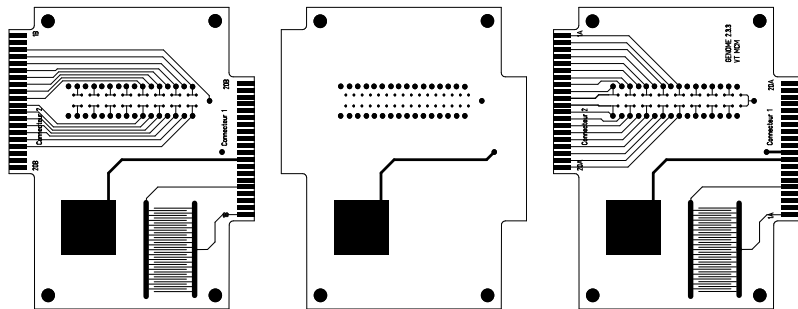
- ▶ Carte relativement complexe
 - ▶ Plusieurs CI
 - ▶ Gros composants magnétiques
 - ▶ Pas adapté à des substrats de puissance (DBC)
- ▶ Besoin de solution de prototypage
 - ▶ Fourniture simple
 - ▶ Bon marché
- ▶ Objectif : à terme 200 °C



→ Utilisation de circuits imprimés (PCB)

- ▶ Étudier le comportement haute température de PCBs
 - ▶ Premiers essais à Ampère sur le vieillissement PCB
 - ▶ Travail sur le protocole d'essais
- ▶ Proposer une technologie PCB pour les drivers
 - ▶ Pas d'étude en cyclage
 - ▶ Étude sous air et sous azote pur

PCB Haute Température – Véhicules de Test



- ▶ PCB 6 couches, 70 μm Cu, finition Ni/Au (6 μm /80 nm)
 - ▶ Un jeu sur FR4 (Panasonic R-1755-V, $T_G > 170^\circ\text{C}$)
 - ▶ Un jeu sur polyimide (Arlon 85N, $T_G > 250^\circ\text{C}$)
- ▶ 3 motifs de test :
 - ▶ SIR (Surface isolation resistance), espacement 500 μm
 - ▶ Capa plane, 20x20 mm²
 - ▶ Série de vias (450 μm de diamètre de trou)

PCB Haute Temp. – Conditions de vieillissement



Source : MMM



- ▶ Vieillissement isotherme (« stockage », température constante)
- ▶ Deux atmosphères de test :
 - ▶ Air (standard, four à convection forcée)
 - ▶ Faible taux d'oxygène (alimentation N_2 , taux O_2 maintenu sous $<0.1\%$)

▶ Surface Isolation Resistance :

- ▶ Polarisation continue : 25 V/mm, avec des connexions HT (voir [20])
- ▶ Caractérisation hebdomadaire hors du four (Keithley 2410 SMU, 200 M Ω max)

▶ Motifs capacité plane

- ▶ Caractérisation hebdomadaire (Keysight E4990 impedance analyzer, 1–2 pF répétabilité)
- ▶ Dispositif de mesure fixe (câbles BNC, connecteur edgeboard)

▶ Résistance des vias

- ▶ Caractérisation hebdomadaire (Keithley 2410 SMU, 10 $\mu\Omega$ resolution)



Source : Keithley

► Surface Isolation Resistance :

- Polarisation continue : 25 V/mm, avec des connexions HT (voir [20])
- Caractérisation hebdomadaire hors du four (Keithley 2410 SMU, 200 M Ω max)

► Motifs capacité plane

- Caractérisation hebdomadaire (Keysight E4990 impedance analyzer, 1–2 pF répétabilité)
- Dispositif de mesure fixe (câbles BNC, connecteur edgeboard)

► Résistance des vias

- Caractérisation hebdomadaire (Keithley 2410 SMU, 10 $\mu\Omega$ resolution)



Source : Keithley



Source : Keysight

► Surface Isolation Resistance :

- Polarisation continue : 25 V/mm, avec des connexions HT (voir [20])
- Caractérisation hebdomadaire hors du four (Keithley 2410 SMU, 200 M Ω max)

► Motifs capacité plane

- Caractérisation hebdomadaire (Keysight E4990 impedance analyzer, 1–2 pF répétabilité)
- Dispositif de mesure fixe (câbles BNC, connecteur edgeboard)

► Résistance des vias

- Caractérisation hebdomadaire (Keithley 2410 SMU, 10 $\mu\Omega$ resolution)



Source : Keithley



Source : Keysight

PCB Haute Température – Caractérisation Physique



Source : Ohaus



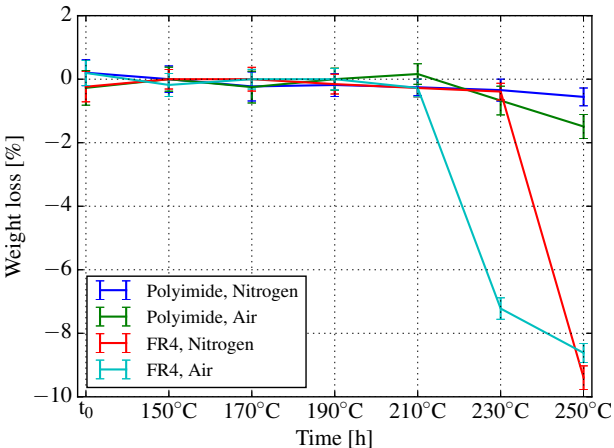
Source : Leica



Source : Presi

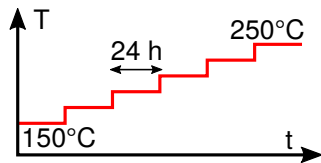
- ▶ Mesure de poids
 - ▶ Caractérisation hebdomadaire avec une balance résolution 1 mg
- ▶ Inspection Visuelle
 - ▶ Photographie hebdomadaire avec bino. Leica M205C
 - ▶ Balance des blancs et éclairage mémorisés
- ▶ Microsections

PCB Haute Température – Tests préliminaires



Step stress

Paliers de 24 h, 20 °C
De 150 à 250 °C

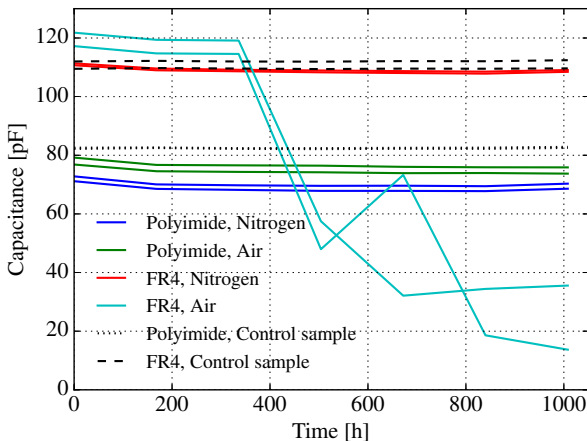


- ▶ Perte de poids mesurée sur de petits coupons (qqes grammes)
- ▶ Pas de variation observée avant le palier 230 °C
- ➔ 190 °C choisi pour les essais 1000 h

- ▶ Deux atmosphères :
 - ▶ **Air**
 - ▶ **Faible taux d'oxygène** (<0.1 %)
- ▶ Cartes séchées 6 h, 120 °C sous air avant les essais
- ▶ Température de stockage : **190 °C**
- ▶ Durée des essais : **6 semaines** (1000 h)
 - ▶ Caractérisation hebdomadaire hors du four

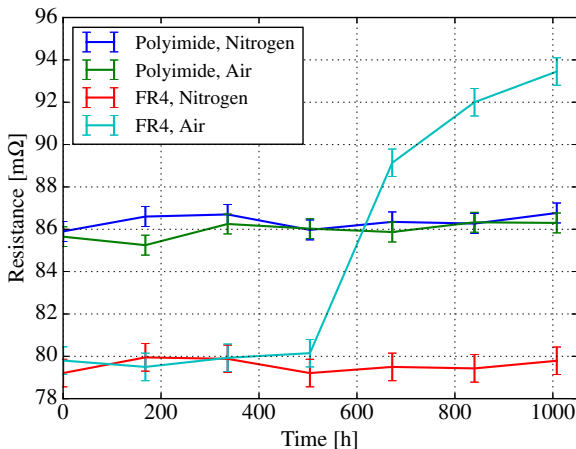
PCB Haute Température – Variation de Capacité

- ▶ Aucun changement, sauf pour le FR4 sous air
- ▶ Pour ce dernier, gonflement autour du motif capacité après 504 h
- ▶ Ces cloques peuvent être causées par les électrodes qui ne sont pas perméables aux gaz de décomposition

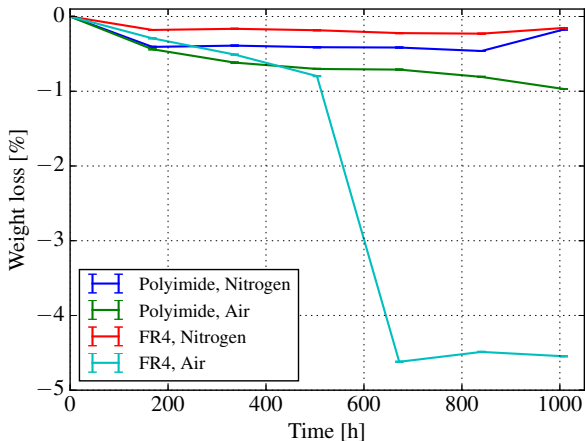


PCB Haute Température – Résistance des Vias

- ▶ Comme pour les capacités, changement visibles pour FR4 sous air
- ▶ Le gonflement du FR4 sous air cause l'augmentation de résistance
- ▶ Décalage d'une semaine par rapport aux condensateurs (672 h)



PCB Haute Température – Perte de poids



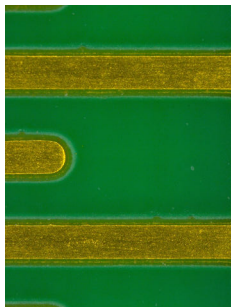
- ▶ Large perte de poids pour le FR4 sous air après 672 h
- ▶ Perte de poids notable (1 %) pour le polyimide sous air
- ▶ Perte de poids négligeable sous N₂, pour polyimide et FR4

PCB Haute Température – Inspection visuelle (190 °C)

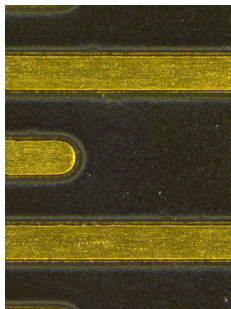
Carte	avant test	1 semaine	2 semaine	3 semaine	4 semaine	5 semaine	6 semaine
FR4 air							
FR4 air							
polyimide air							
polyimide air							
FR4 N ₂							
polyimide N ₂							

Amfese

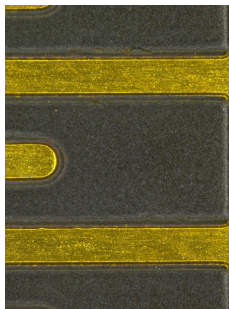
PCB Haute Température – Inspection visuelle (190 °C)



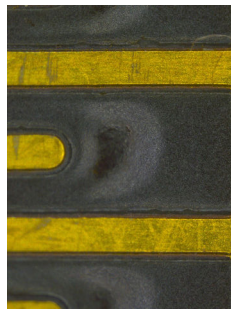
Initial



1 sem.(168 h)



3 sem. (504 h)



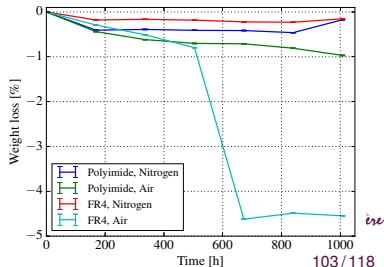
4 sem. (672 h)

FR4, sous air

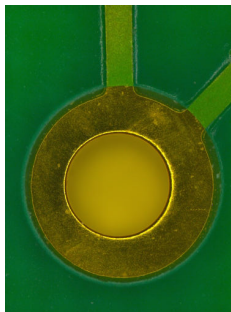
1 semaine : noircissement du solder resist

3 semaines : aspect mat

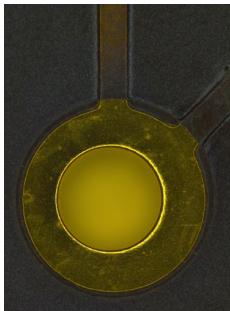
4 semaines : inhomogénéités d'aspect, forte perte de poids



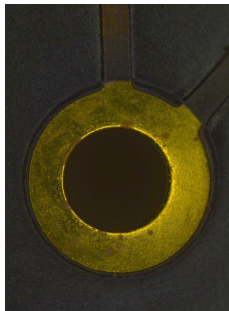
PCB Haute Température – Inspection visuelle (190 °C)



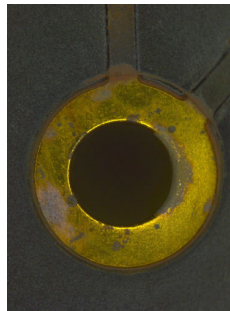
Initial



3 sem. (504 h)



4 sem. (672 h)



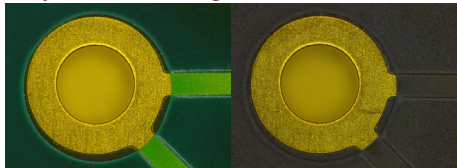
6 sem. (1008 h)

FR4, sous air

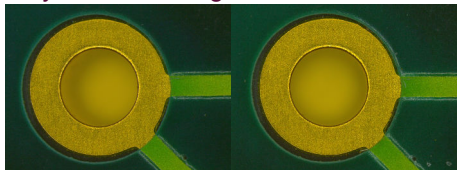
- ▶ Le métal des vias (Ni/Au sur Cu) garde son aspect jusqu'à 3 semaines
- ▶ Des marques de corrosion apparaissent après 4 semaines
- ▶ Corrélié à la perte de poids

PCB Haute Température – Inspection visuelle (190 °C)

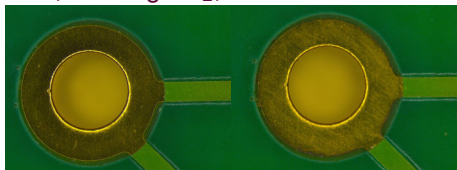
Polyimide, stockage air , intial – 6 sem.



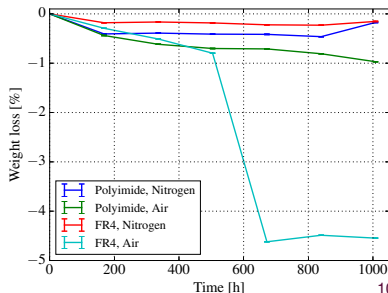
Polyimide, stockage N₂, intial – 6 sem.



FR4, stockage N₂, intial – 6 sem.

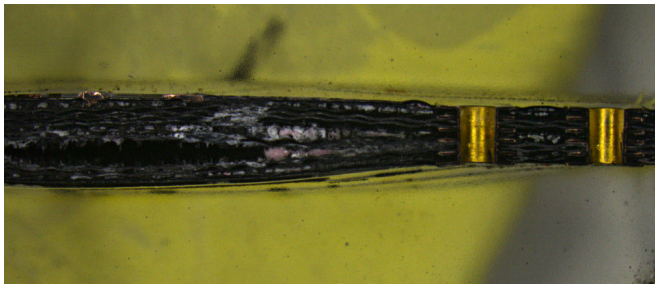


- ▶ Pour le polyimide :
 - ▶ Sous air, noircissement du solder resist
 - ▶ Pas d'autre changement notable
 - ▶ Sous azote, pas de changement
- ▶ pour le FR4 sous azote :
 - ▶ Pas de changement visuel
 - ▶ Pas de corrosion de la finition Au



PCB Haute Température – Surface Isolation Resistance (SIR)

- ▶ Deux motifs SIR polarisés et caractérisés par carte :
 - ▶ Un avec finition Ni/Au
 - ▶ Un avec finition Ni/Au et brasure SAC sérigraphiée
- ▶ Tous les motifs dépassent 200 M Ω (limite de la mesure) sauf le FR4 sous air
 - ▶ Pour le FR4 sous air, le SIR chute à \approx 1M Ω après 4 semaines
 - ▶ Même comportement pour les motifs Au et SAC
 - ▶ Finalement, gonflement tel que la caractérisation devient impossible



- ▶ Pour les échantillons stockés sous N_2 :
 - ▶ Pas de changement notable (polyimide et FR4)
- ▶ Pour les échantillons stockés sous air :
 - ▶ Noircissement rapide (FR4 et polyimide) :
 - ▶ Après ça, pas de dégradation du polyimide (mis à part une lente perte de poids, 1 % sur 1000 h)
 - ▶ Forte dégradation du FR4 sous air après 3 semaines :

- ▶ Pour les échantillons stockés sous N₂ :
 - ▶ Pas de changement notable (polyimide et FR4)
- ▶ Pour les échantillons stockés sous air :
 - ▶ Noircissement rapide (FR4 et polyimide) :
 - Dégradation du solder resist
 - ▶ Après ça, pas de dégradation du polyimide (mis à part une lente perte de poids, 1 % sur 1000 h)
 - ▶ Forte dégradation du FR4 sous air après 3 semaines :
 - 3 semaines : Gonflement, d'abord sous les plans de cuivre
 - 4 semaines : Le gonflement se propage, forte perte de poids
 - 5-6 semaines : Corrosion des finitions Au.

- ▶ Pour les échantillons stockés sous N_2 :
 - ▶ Pas de changement notable (polyimide et FR4)
- ▶ Pour les échantillons stockés sous air :
 - ▶ Noircissement rapide (FR4 et polyimide) :
 - Dégradation du solder resist
 - ▶ Après ça, pas de dégradation du polyimide (mis à part une lente perte de poids, 1 % sur 1000 h)
 - ▶ Forte dégradation du FR4 sous air après 3 semaines :
 - 3 semaines : Gonflement, d'abord sous les plans de cuivre
 - 4 semaines : Le gonflement se propage, forte perte de poids
 - 5-6 semaines : Corrosion des finitions Au.

- ▶ Pour les échantillons stockés sous N_2 :
 - ▶ Pas de changement notable (polyimide et FR4)
- ▶ Pour les échantillons stockés sous air :
 - ▶ Noircissement rapide (FR4 et polyimide) :
 - Dégradation du solder resist
 - ▶ Après ça, pas de dégradation du polyimide (mis à part une lente perte de poids, 1 % sur 1000 h)
 - ▶ Forte dégradation du FR4 sous air après 3 semaines :
 - 3 semaines** : Gonflement, d'abord sous les plans de cuivre
 - 4 semaines** : Le gonflement se propage, forte perte de poids
 - 5–6 semaines** : Corrosion des finitions Au.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ **Les caractérisations simples sont utiles :**
 - ▶ Perte de poids (même hors four, avec une balance standard)
 - ▶ Inspection visuelle (avec prise de vue reproductible)
- ▶ **Les tests électriques apportent peu, mais sont nécessaires :**
 - ▶ SIR
 - ▶ Résistance des vias
- ▶ **Les capacités planes ont accéléré le gonflement**
 - ▶ Il avait débuté de toutes façons
 - ▶ Besoin de motifs de cuivre représentatifs pour les cartes de test
 - ▶ Les plans de masse pleins sont à déconseiller. (Motifs grillagés mieux)
- ▶ Pas de problème lié aux tests hebdomadaires hors four
- ▶ Les connecteurs edgeboard HT sont fiables (sauf gonflement carte)
- ▶ Pas de tests mécaniques effectués, mais pas de décollement visible.

- ▶ Comme prévu, le FR4 ($T_g > 170$ °C) est plus sensible à la température que le polyimide ($T_g > 250$ °C)
- ▶ Le solder resist se dégrade rapidement à 190 °C
 - ▶ Cela ne semble pas avoir de grandes conséquences
- ▶ L'atmosphère joue un rôle prépondérant
 - ▶ Sous air, même le polyimide se dégrade, plus lentement que le FR4
 - ▶ Sous azote, pas de vieillissement observé
 - ▶ Intéressant pour des tests labos (PCB FR4 moins chers)
 - ⚠ Nous n'avons pas fait de cyclage thermique

- ▶ Comme prévu, le FR4 ($T_g > 170$ °C) est plus sensible à la température que le polyimide ($T_g > 250$ °C)
- ▶ Le solder resist se dégrade rapidement à 190 °C
 - ▶ Cela ne semble pas avoir de grandes conséquences
- ▶ L'atmosphère joue un rôle prépondérant
 - ▶ Sous air, même le polyimide se dégrade, plus lentement que le FR4
 - ▶ Sous azote, pas de vieillissement observé
 - ▶ Intéressant pour des tests labos (PCB FR4 moins chers)
 - ⚠ Nous n'avons pas fait de cyclage thermique

- ▶ Comme prévu, le FR4 ($T_g > 170$ °C) est plus sensible à la température que le polyimide ($T_g > 250$ °C)
- ▶ Le solder resist se dégrade rapidement à 190 °C
 - ▶ Cela ne semble pas avoir de grandes conséquences
- ▶ L'atmosphère joue un rôle prépondérant
 - ▶ Sous air, même le polyimide se dégrade, plus lentement que le FR4
 - ▶ Sous azote, pas de vieillissement observé
 - ▶ Intéressant pour des tests labos (PCB FR4 moins chers)
 - ▶ **⚠** Nous n'avons pas fait de cyclage thermique

Introduction

Composants

semiconducteurs de puissance

Circuits de commande

Passifs

Packaging et Procédés

Généralités Packaging

Attache de composants

Circuits imprimés

Conclusions

L'électronique haute température pose des problèmes :

- ▶ **De composants**

- ▶ Actifs « grands gaps » pour la puissance,
- ▶ Circuits intégrés Si pour la basse tension
- ▶ Gros manques au niveau des passifs (capas surtout)

- ▶ **De packaging**

- ▶ Haute température :
 - ▶ Dégradation des matériaux organiques
 - ▶ Diffusion des espèces chimiques
- ▶ Fort cyclage
 - ▶ Problèmes thermo-mécaniques

À 200 °C, des solutions sont applicables et disponibles
(avec précautions et vérifications)

Au-delà de 300 °C

▶ **Presque plus de composants**

- ▶ Quelques composants grands gaps,
- ▶ Circuits intégrés SiC ou GaN nécessaires
- ▶ Plus de capas (hors SiO₂)

▶ **Et pour le packaging**

- ▶ Presque plus de matériaux organiques
 - ▶ Substrats céramiques uniquement
 - ▶ Durée de vie inconnue
- ▶ Pour le moment, surtout applications capteurs
- ▶ Encore beaucoup de travail de recherche !

Remerciements

- ▶ Aux doctorants : Amandine, Rémi, Khalil, Raphaël, Stanislas, Wissam, Oriol,
- ▶ Aux collègues d'Ampère : Christian, Hervé, Christophe, Dominique, Pascal, Bruno
- ▶ À ceux des autres labos : LAPLACE, IMS, SATIE
- ▶ À l'école d'été grands gaps pour l'invitation !

Pour me faire part de vos remarques, pour des questions :
cyril.buttay@insa-lyon.fr



- ▶ picture of the Airbus A350 : airbus
- ▶ picture of the Toyota Prius : Picture by Pawel Golsztajn, CC-SA, available on Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toyota_Prius.2.JPG
- ▶ geothermal power plant : <http://energy.gov/eere/geothermal/photos/geothermal-photo-gallery>
- ▶ picture of Jupiter : NASA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PIA04866_modest.jpg

References |



C. Raynaud, D. Tournier, H. Morel, and D. Planson, "Comparison of high voltage and high temperature performances of wide bandgap semiconductors for vertical power devices," *Diamond and Related Materials*, vol. 19, no. 1, pp. 1–6, 2010. [Online]. Available : <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6TWV-4XCJ4M2-1/2/76c76271c9345bf77d4fc29077179d2a>



R. Pérez, N. Mestres, D. Tournier, X. Jordà, P. Godignon, and M. Vellvehi, "Temperature Dependence of 4H-SiC JBS and Schottky Diodes after High Temperature Treatment of Contact Metal," *Materials Science Forum*, vol. 483–485, pp. 945–948, May 2005. [Online]. Available : <http://www.scientific.net/MSF.483-485.945>



N. Lundberg, M. Östling, C.-M. Zetterling, P. Tägtström, and U. Jansson, "CVD-based tungsten carbide schottky contacts to 6H-SiC for very high-temperature operation," *Journal of Electronic Materials*, vol. 29, pp. 372–375, 2000.



C. Buttay, R. Robutel, C. Martin, C. Raynaud, S. Dampieni, D. Bergogne, and T. Chailloux, "Effect of High Temperature Ageing on Active and Passive Power Devices," in *HITEC 2010*, Albuquerque, United States, May 2010, p. 000228. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00485273>



C. Buttay, C. Raynaud, H. Morel, G. Civrac, M.-L. Locatelli, and F. Morel, "Thermal Stability of Silicon Carbide Power Diodes," *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 59, no. 3, pp. 761–769, 2012. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00672440>









C. Buttay, R. Ouaida, H. Morel, D. Bergogne, C. Raynaud, and F. Morel, "Thermal Stability of Silicon Carbide Power JFETs," *IEEE transactions on Electron Devices*, vol. 60, no. 12, pp. 4191–4198, Dec. 2013. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00881667>



K. El Falahi, "Contribution à la conception de driver en technologie CMOS SOI pour la commande de transistors JFET SiC pour un environnement de haute température," Ph.D. dissertation, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Villeurbanne, Jun. 2012. [Online]. Available : <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00770657>

References II

-  K. El Falahi, S. Hascoët, C. Buttay, P. Bevilacqua, L. V. Phung, D. Tournier, B. Allard, and D. Planson, "High temperature, Smart Power Module for aircraft actuators," in *Proceedings of the High Temperature Electronics Network (HiTEN)*. Oxford, UK : IMAPS, Jul. 2013. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00874666>
-  R. Robutel, "Passive components for high temperature power electronics : application to the EMI input filter," Theses, INSA de Lyon, Nov. 2011. [Online]. Available : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00665819>
-  W. Sabbah, P. Bondue, O. Avino-Salvado, C. Buttay, H. Frémont, A. Guédon-Gracia, and H. Morel, "High temperature ageing of microelectronics assemblies with SAC solder joints," *Microelectronics Reliability*, 2017. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01564755>
-  M. Berthou, P. Retailleau, H. Frémont, A. Guédon-Gracia, and C. Jéphos-Davennel, "Microstructure evolution observation for SAC solder joint : Comparison between thermal cycling and thermal storage," *Microelectronics Reliability*, vol. 49, no. 9–11, pp. 1267 – 1272, 2009, 20th European Symposium on the Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis 20th European Symposium on the Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis. [Online]. Available : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271409002509>
-  W. Gale and D. Butts, "Transient liquid phase bonding," *Science and Technology of Welding and Joining*, vol. 9, no. 4, pp. 283–300, 2004. [Online]. Available : <http://www.ingentaconnect.com/content/maney/stwj/2004/00000009/00000004/art00001>
-  H. Greve and F. P. McCluskey, "LT-TLPS Die Attach for High Temperature Electronic Packaging," in *Proceedings of the High Temperature Electronics Network (HiTEN)*. Oxford, UK : IMAPS, Jul. 2013, pp. 246–253.

References III



D. Bernache-Assollant and J.-P. Bonnet, *Frittage : aspects physico-chimiques - Partie 1 : frittage en phase solide*. Techniques de l'ingénieur, 2005, vol. AF 6 620, ch. Physique Chimie, p. 10. [Online]. Available : <http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/sciences-fondamentales-th8/fondamentaux-en-chimie-42106210/frittage-aspects-physico-chimiques-af6620/>



G. Bai, "Low-Temperature Sintering of Nanoscale Silver Paste for Semiconductor Device Interconnection," Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, Oct. 2005. [Online]. Available : <http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-10312005-163634/unrestricted/Dissertation-GBai05.pdf>



A. Masson, W. Sabbah, R. Riva, C. Buttay, S. Azzopardi, H. Morel, D. Planson, and R. Meuret, "Die attach using silver sintering. Practical implementation and analysis," *European Journal of Electrical Engineering*, vol. 16, no. 3-4, pp. 293–305, 2013. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00874465>



J. Billore, S. Hascoët, R. Robutel, C. Buttay, and J. Li, "Sintered-Silver Bonding of High-Temperature Piezoelectric Ceramic Sensors," *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, pp. 1–7, 2016. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01419042>



S. Hascoët, "Mise en œuvre de nouveaux matériaux d'assemblage dans les modules multipuces de puissance (MCM)," Ph.D. dissertation, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Villeurbanne, Nov. 2013.



R. Riva, C. Buttay, B. Allard, and P. Bevilacqua, "Migration issues in sintered-silver die attaches operating at high temperature," *Microelectronics Reliability*, vol. 53, pp. 1592–1506, 2013. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00874458>



O. Avino-Salvado, W. Sabbah, C. Buttay, H. Morel, and P. Bevilacqua, "Evaluation of printed-circuit boards materials for high temperature operation," in *International Conference and Exhibition on High Temperature Electronics Network (HiTEN 2017)*, ser. Proceedings of the High Temperature Electronics Network (HiTEN 2017). Cambridge, United Kingdom : IMAPS, Jul. 2017. [Online]. Available : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01565131>